

UTILITY PATENT APPLICATION TRANSMITTAL
(Large Entity)*(Only for new nonprovisional applications under 37 CFR 1.53(b))*Docket No.
KIX0103-US

Total Pages in this Submission

TO THE ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTSBox Patent Application
Washington, D.C. 20231

Transmitted herewith for filing under 35 U.S.C. 111(a) and 37 C.F.R. 1.53(b) is a new utility patent application for an invention entitled:

INFRARED DATA COMMUNICATION MODULE AND METHOD OF MAKING THE SAME

and invented by:

TOMOHARU HORIOIf a **CONTINUATION APPLICATION**, check appropriate box and supply the requisite information:☐ Continuation ☐ Divisional ☐ Continuation-in-part (CIP) of prior application No.: _____

Which is a:

☐ Continuation ☐ Divisional ☐ Continuation-in-part (CIP) of prior application No.: _____

Which is a:

☐ Continuation ☐ Divisional ☐ Continuation-in-part (CIP) of prior application No.: _____

Enclosed are:

Application Elements

1. ☒ Filing fee as calculated and transmitted as described below
2. ☒ Specification having 21 pages and including the following:
 - a. ☒ Descriptive Title of the Invention
 - b. ☐ Cross References to Related Applications *(if applicable)*
 - c. ☐ Statement Regarding Federally-sponsored Research/Development *(if applicable)*
 - d. ☐ Reference to Microfiche Appendix *(if applicable)*
 - e. ☒ Background of the Invention
 - f. ☒ Brief Summary of the Invention
 - g. ☒ Brief Description of the Drawings *(if drawings filed)*
 - h. ☒ Detailed Description
 - i. ☒ Claim(s) as Classified Below
 - j. ☒ Abstract of the Disclosure

UTILITY PATENT APPLICATION TRANSMITTAL (Large Entity)

(Only for new nonprovisional applications under 37 CFR 1.53(b))

Docket No.
KIX0103-US

Total Pages in this Submission

Application Elements (Continued)

3. ☒ Drawing(s) (when necessary as prescribed by 35 USC 113)
- a. ☒ Formal Number of Sheets 16 (SIXTEEN)
- b. ☐ Informal Number of Sheets _____
4. ☒ Oath or Declaration
- a. ☒ Newly executed (original or copy) ☐ Unexecuted
- b. ☐ Copy from a prior application (37 CFR 1.63(d)) (for continuation/divisional application only)
- c. ☒ With Power of Attorney ☐ Without Power of Attorney
- d. ☐ DELETION OF INVENTOR(S)
Signed statement attached deleting inventor(s) named in the prior application,
see 37 C.F.R. 1.63(d)(2) and 1.33(b).
5. ☐ Incorporation By Reference (usable if Box 4b is checked)
The entire disclosure of the prior application, from which a copy of the oath or declaration is supplied under Box 4b, is considered as being part of the disclosure of the accompanying application and is hereby incorporated by reference therein.
6. ☐ Computer Program in Microfiche (Appendix)
7. ☐ Nucleotide and/or Amino Acid Sequence Submission (if applicable, all must be included)
- a. ☐ Paper Copy
- b. ☐ Computer Readable Copy (identical to computer copy)
- c. ☐ Statement Verifying Identical Paper and Computer Readable Copy

Accompanying Application Parts

8. ☒ Assignment Papers (cover sheet & document(s))
9. ☐ 37 CFR 3.73(B) Statement (when there is an assignee)
10. ☐ English Translation Document (if applicable)
11. ☒ Information Disclosure Statement/PTO-1449 ☒ Copies of IDS Citations
12. ☐ Preliminary Amendment
13. ☒ Acknowledgment postcard
14. ☐ Certificate of Mailing
- ☐ First Class ☐ Express Mail (Specify Label No.): _____

UTILITY PATENT APPLICATION TRANSMITTAL (Large Entity)

(Only for new nonprovisional applications under 37 CFR 1.53(b))

Docket No.
KIX0103-US

Total Pages in this Submission

Accompanying Application Parts (Continued)

15. ☐ Certified Copy of Priority Document(s) (if foreign priority is claimed)

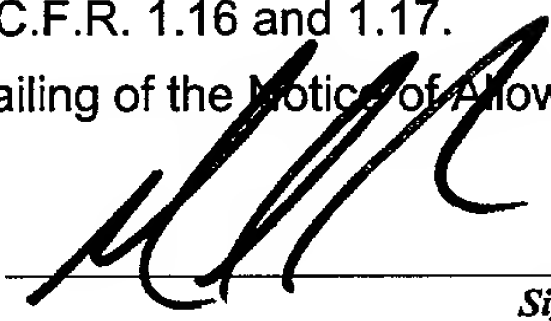
16. ☐ Additional Enclosures (please identify below):

Fee Calculation and Transmittal

CLAIMS AS FILED

For	#Filed	#Allowed	#Extra	Rate	Fee
Total Claims	20	- 20 =	0	x \$18.00	\$0.00
Indep. Claims	3	- 3 =	0	x \$78.00	\$0.00
Multiple Dependent Claims (check if applicable) <input type="checkbox"/>					\$0.00
BASIC FEE					\$690.00
OTHER FEE (specify purpose) <u>Assignment Recordation Fee</u>					\$40.00
TOTAL FILING FEE					\$730.00

- ☒ A check in the amount of \$730.00 to cover the filing fee is enclosed.
- ☒ The Commissioner is hereby authorized to charge and credit Deposit Account No. 50-1390 as described below. A duplicate copy of this sheet is enclosed.
- ☐ Charge the amount of _____ as filing fee.
- ☒ Credit any overpayment.
- ☒ Charge any additional filing fees required under 37 C.F.R. 1.16 and 1.17.
- ☐ Charge the issue fee set in 37 C.F.R. 1.18 at the mailing of the Notice of Allowance, pursuant to 37 C.F.R. 1.311(b).


Signature

Michael D. Bednarek
Regn. No. 32,329
Shawpittman
2300 N Street, N.W.
Washington, D.C. 20037-1128

Dated: AUGUST 31, 2000

CC:

FIG.3

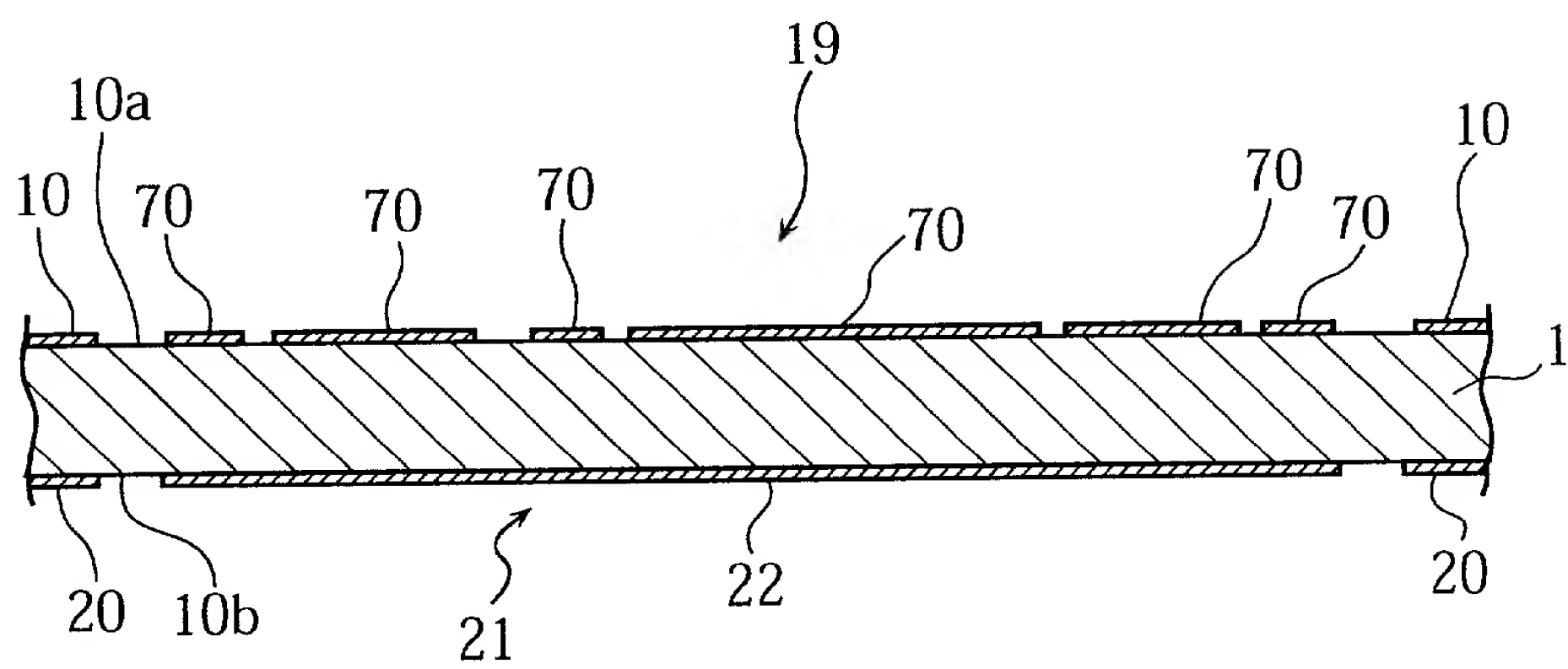


FIG.4

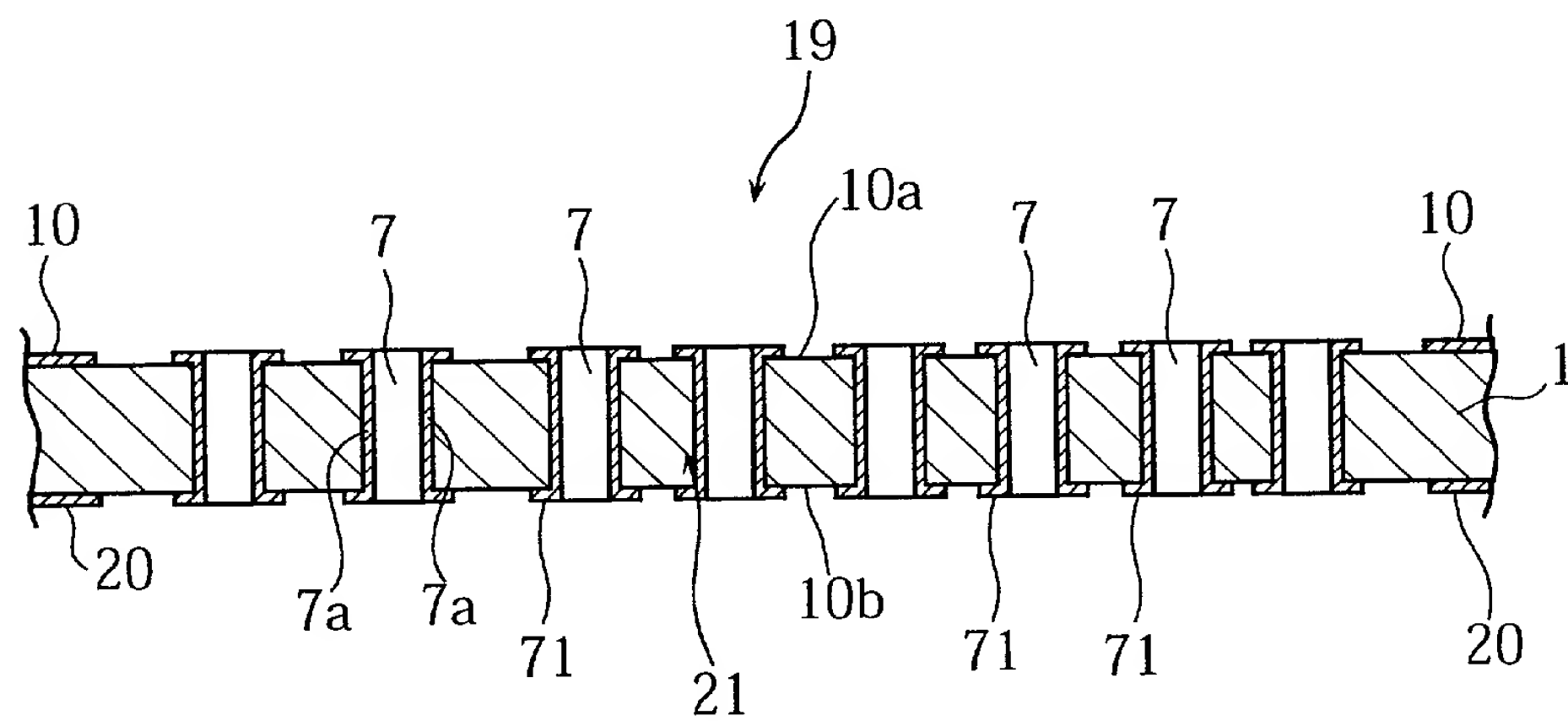


FIG. 5

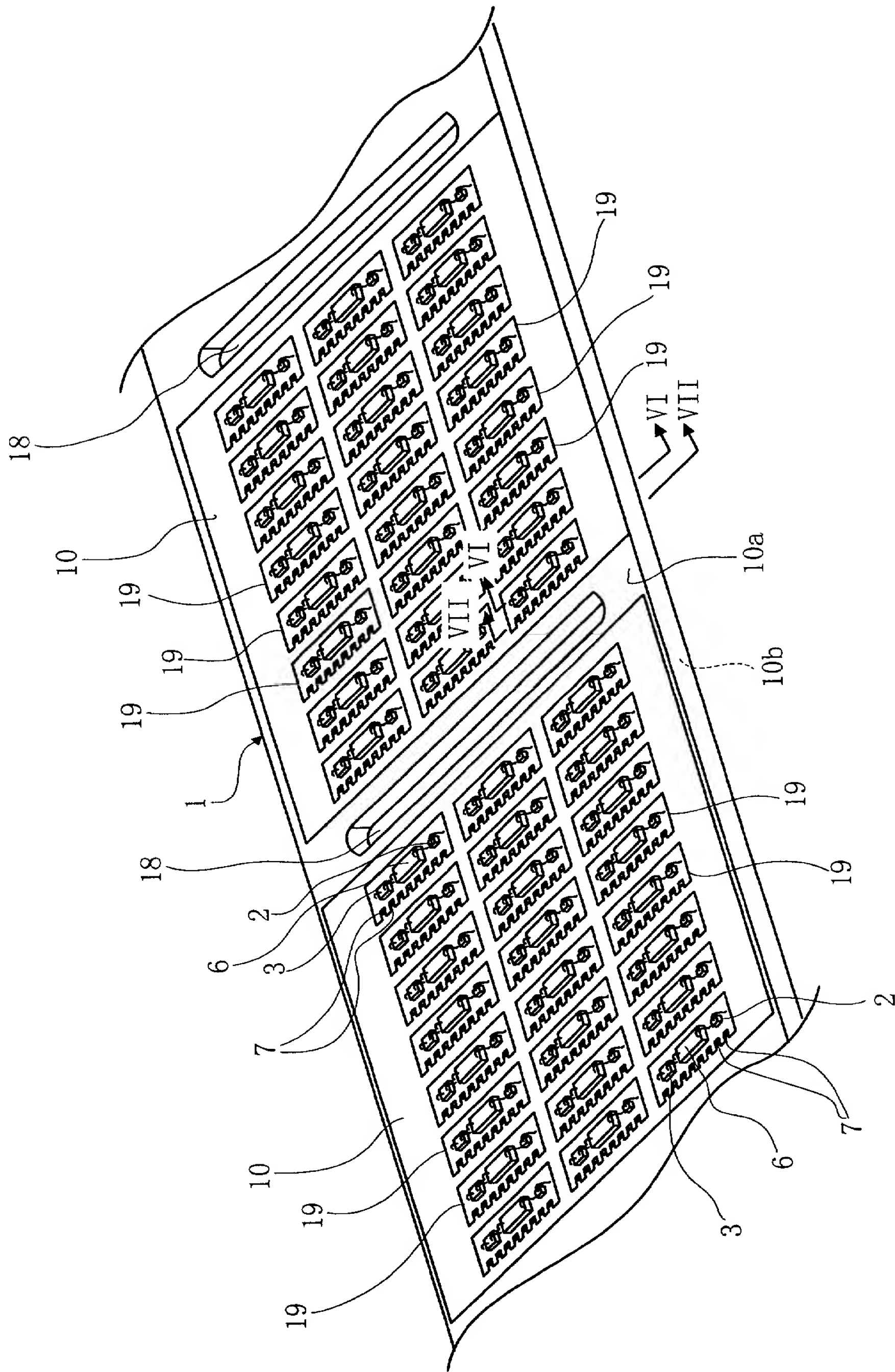


FIG.6

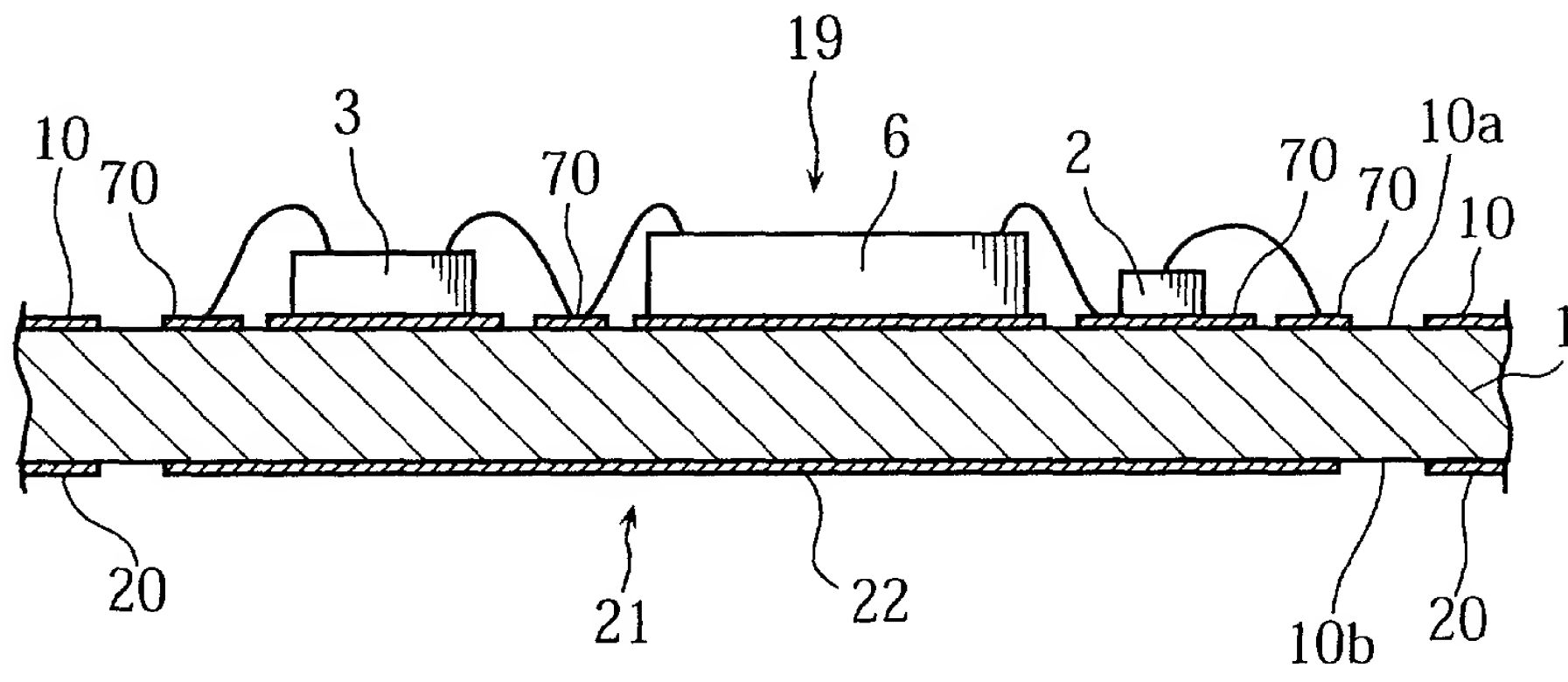


FIG.7

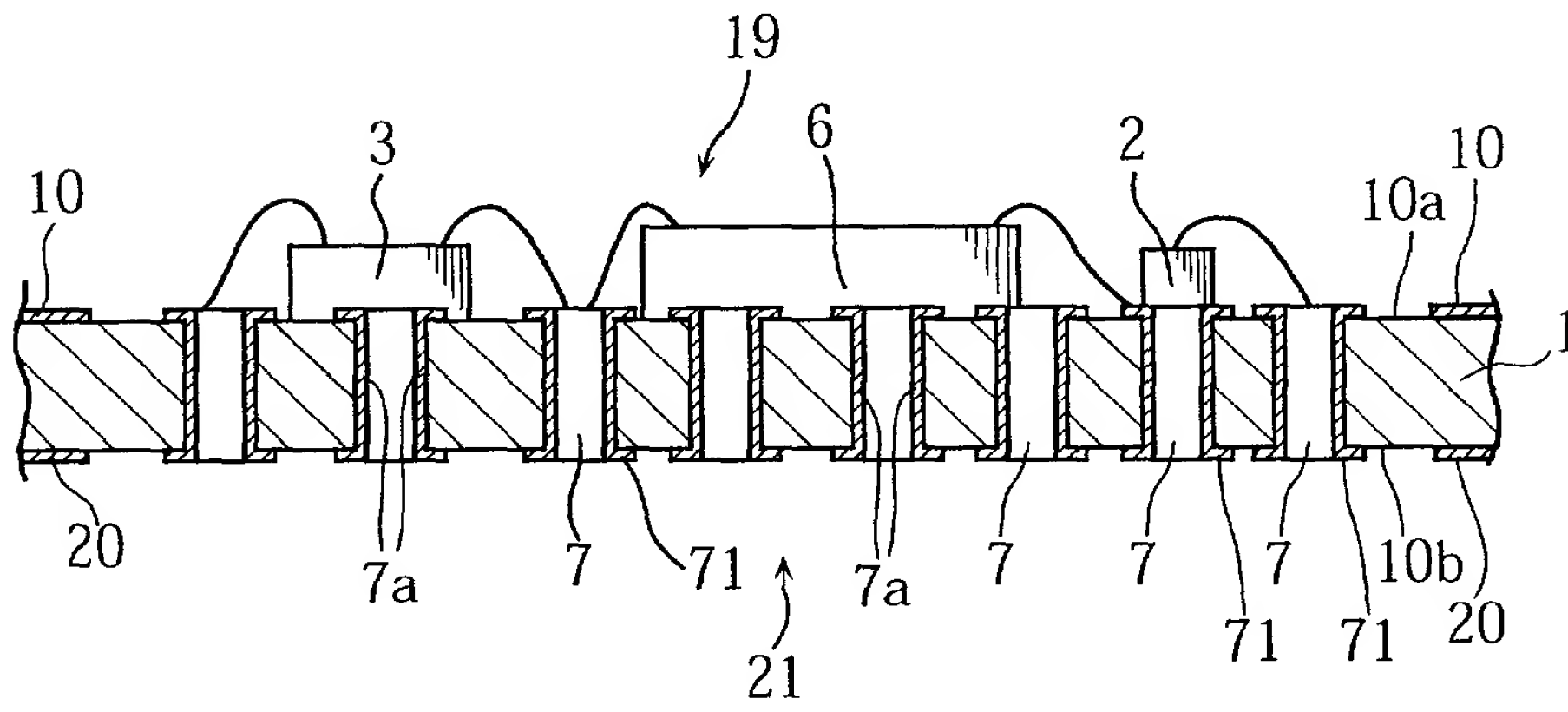


FIG. 8

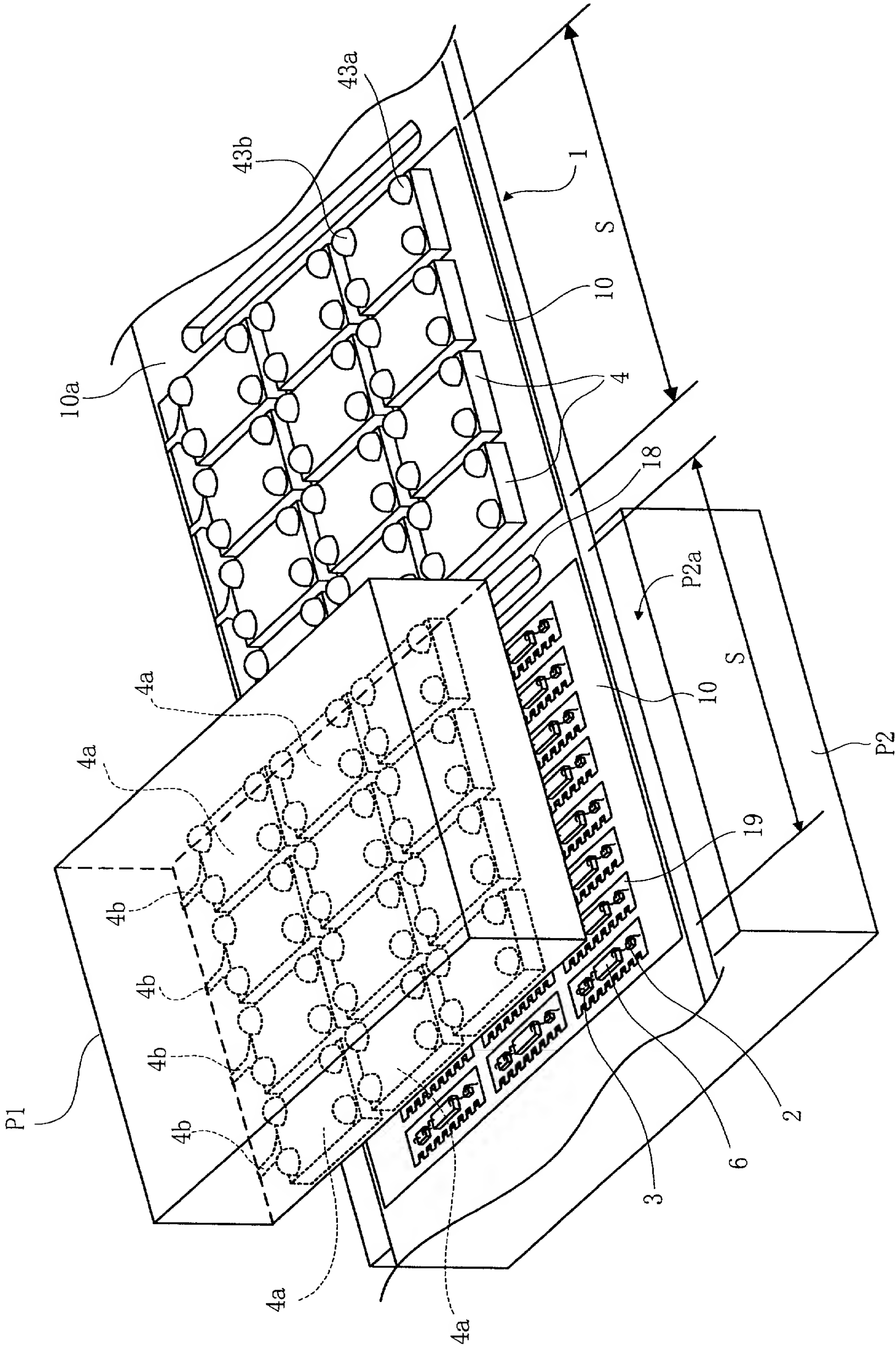


FIG. 9

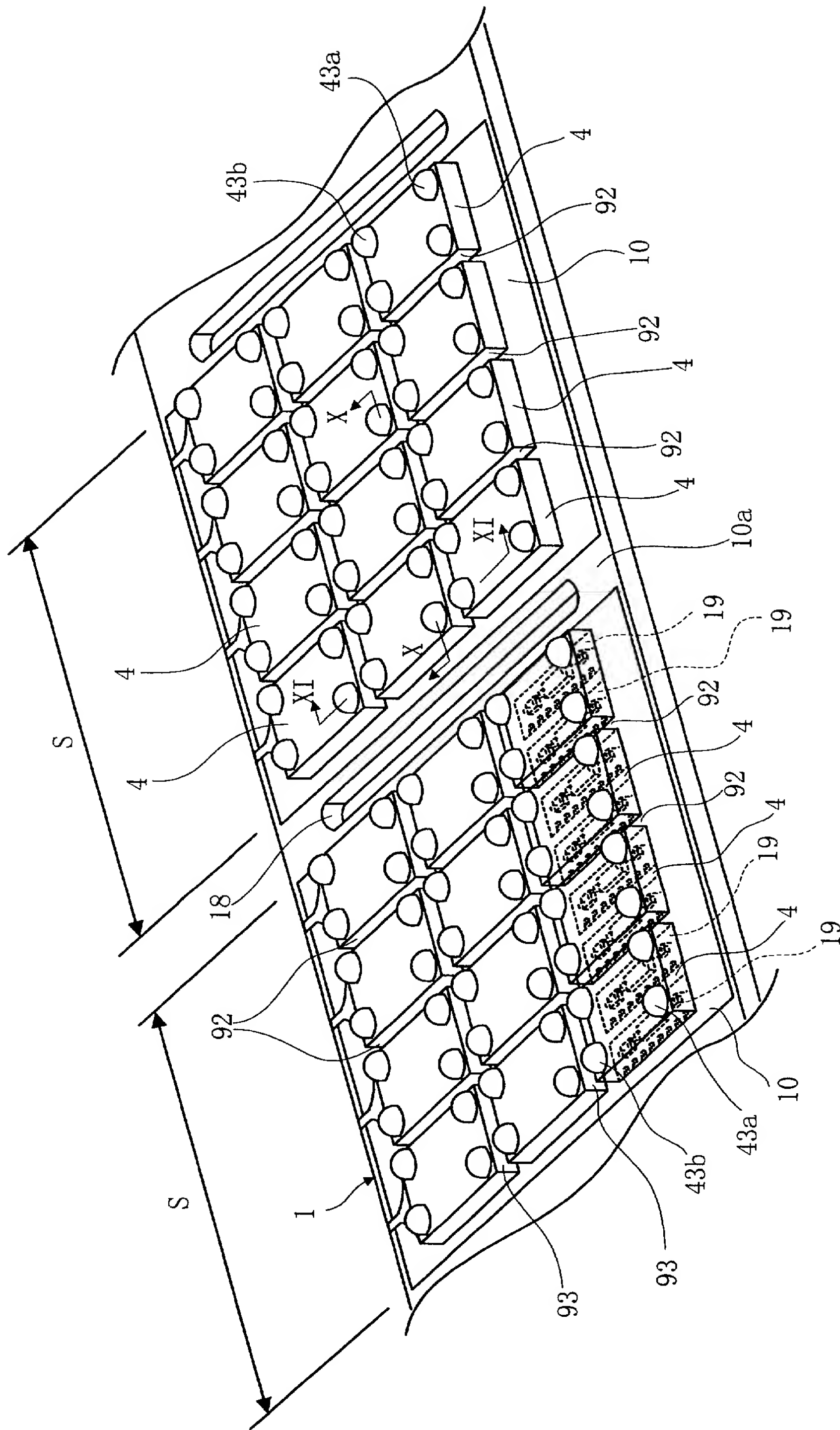


FIG.10

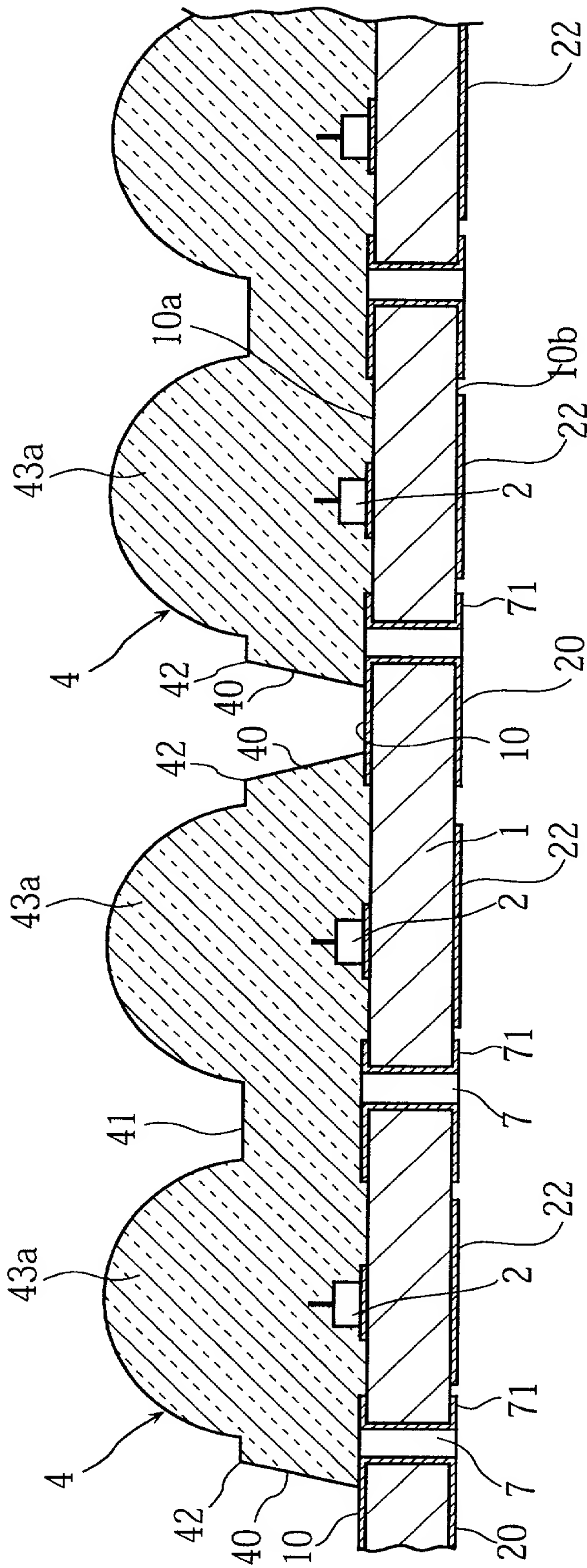


FIG.12

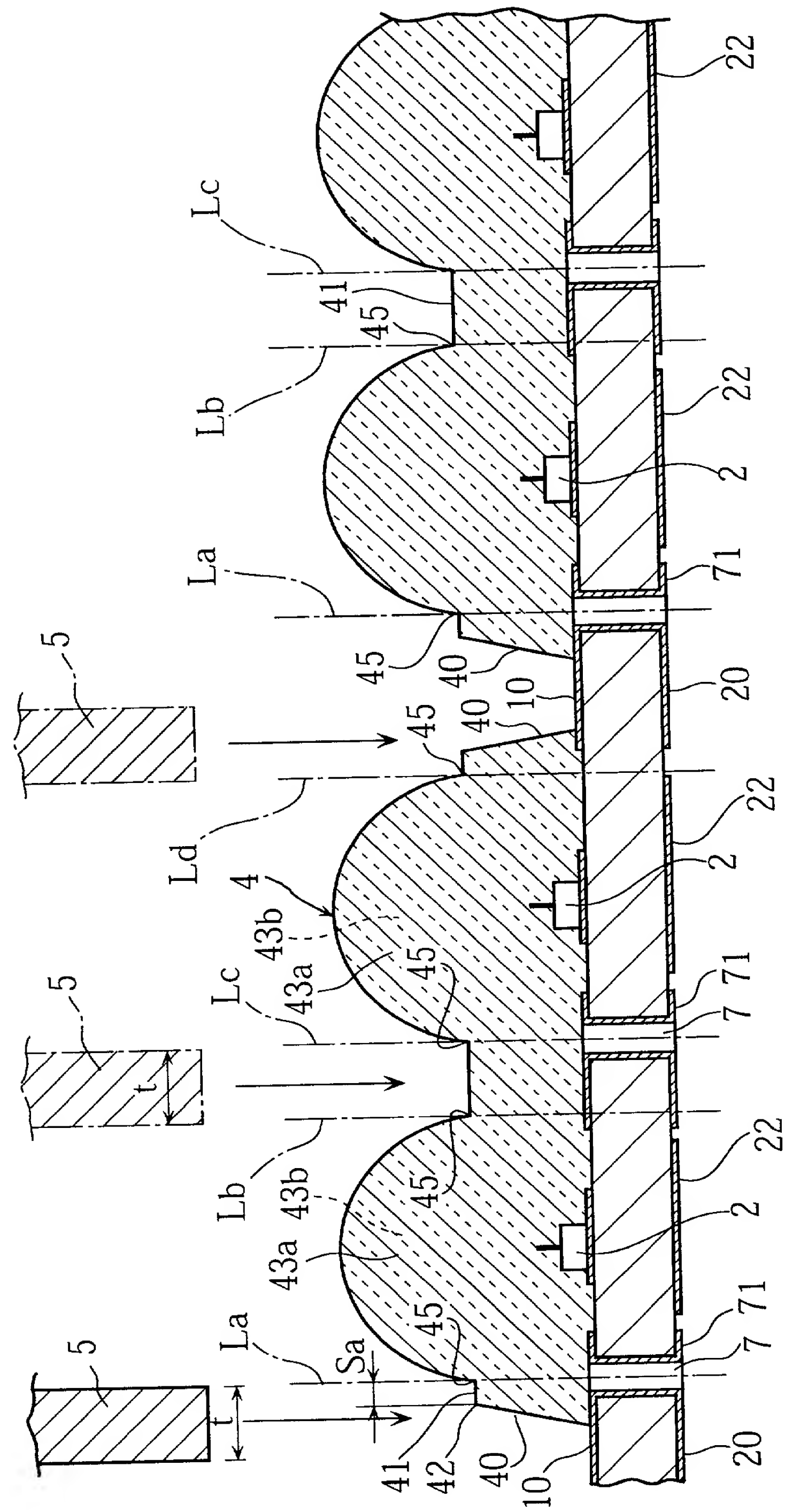


FIG.13

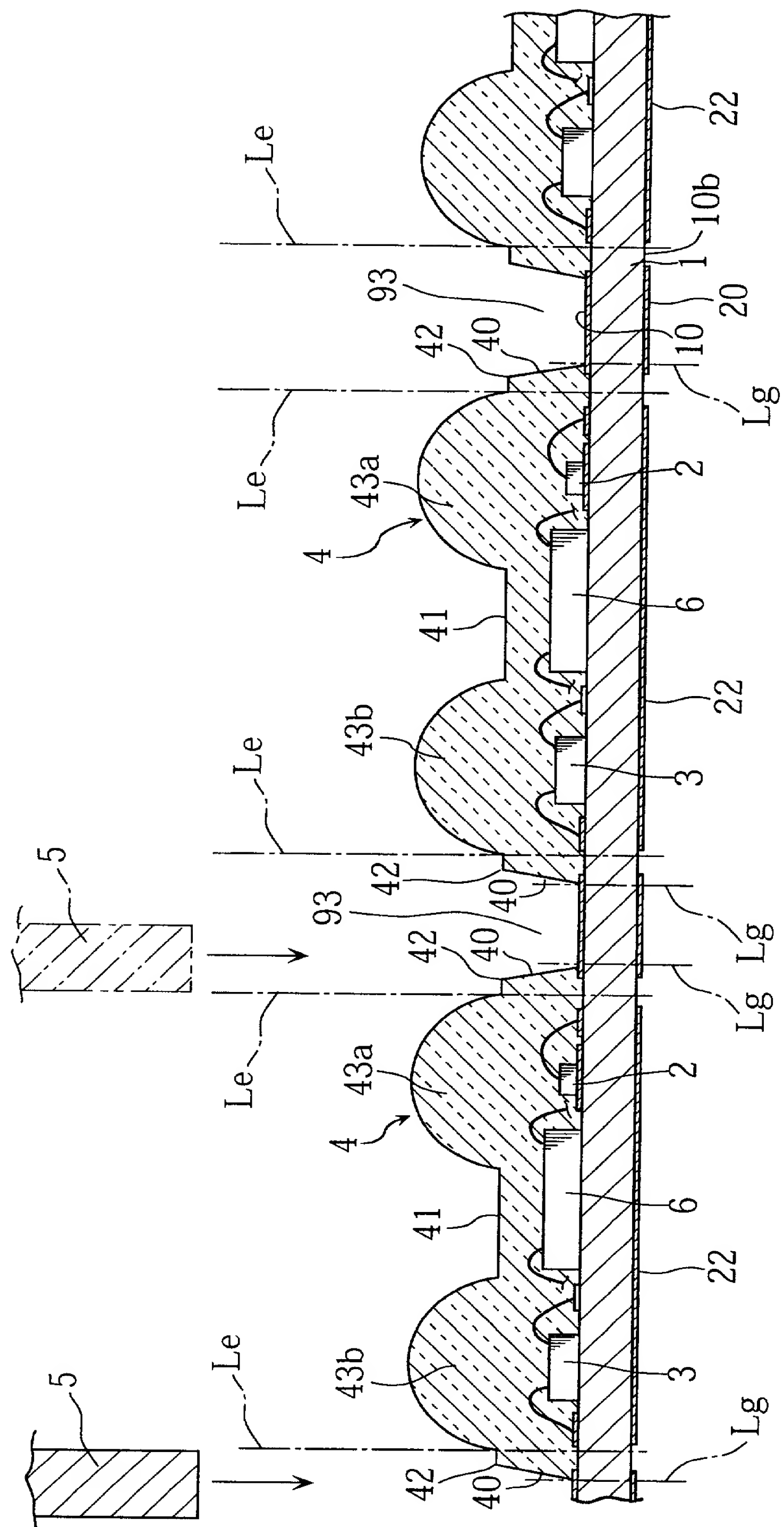


Table 1. Demographic characteristics of the study population	
Age (years)	65.0 ± 10.0
Gender	
Male	50.0%
Female	50.0%
Education (years)	12.0 ± 2.0
Marital status	
Married	70.0%
Single	30.0%
Occupation	
Retired	60.0%
Unemployed	40.0%
Income (USD/month)	1,500 ± 500
Health status	
Good	75.0%
Fair	25.0%
Poor	0.0%
Comorbidities	
Hypertension	45.0%
Diabetes	30.0%
Cholesterol	55.0%
Smoking status	
Smoker	20.0%
Non-smoker	80.0%
Alcohol consumption	
Regular	10.0%
Occasional	30.0%
Never	60.0%
Family size	3.0 ± 1.0
Living alone	15.0%
Living with family	85.0%
Access to healthcare	
Regular visits	70.0%
Irregular visits	30.0%
Health insurance	
Yes	85.0%
No	15.0%
Medication adherence	
High	60.0%
Low	40.0%
Health literacy	
High	70.0%
Low	30.0%
Health beliefs	
Positive	65.0%
Negative	35.0%
Health behaviors	
Healthy	75.0%
Unhealthy	25.0%
Health status change	
Improved	40.0%
Stable	50.0%
Deteriorated	10.0%
Healthcare utilization	
High	60.0%
Low	40.0%
Healthcare costs	
High	30.0%
Low	70.0%
Healthcare satisfaction	
High	65.0%
Low	35.0%
Healthcare access	
Good	70.0%
Poor	30.0%
Healthcare quality	
High	60.0%
Low	40.0%
Healthcare safety	
High	75.0%
Low	25.0%
Healthcare effectiveness	
High	65.0%
Low	35.0%
Healthcare equity	
High	70.0%
Low	30.0%
Healthcare efficiency	
High	60.0%
Low	40.0%
Healthcare sustainability	
High	75.0%
Low	25.0%
Healthcare innovation	
High	65.0%
Low	35.0%
Healthcare leadership	
High	70.0%
Low	30.0%
Healthcare governance	
High	60.0%
Low	40.0%
Healthcare accountability	
High	75.0%
Low	25.0%
Healthcare transparency	
High	65.0%
Low	35.0%
Healthcare integrity	
High	70.0%
Low	30.0%
Healthcare responsibility	
High	60.0%
Low	40.0%
Healthcare ethics	
High	75.0%
Low	25.0%
Healthcare professionalism	
High	65.0%
Low	35.0%
Healthcare collaboration	
High	70.0%
Low	30.0%
Healthcare communication	
High	60.0%
Low	40.0%
Healthcare partnership	
High	75.0%
Low	25.0%
Healthcare engagement	
High	65.0%
Low	35.0%
Healthcare involvement	
High	70.0%
Low	30.0%
Healthcare participation	
High	60.0%
Low	40.0%
Healthcare contribution	
High	75.0%
Low	25.0%
Healthcare commitment	
High	65.0%
Low	35.0%
Healthcare dedication	
High	70.0%
Low	30.0%
Healthcare loyalty	
High	60.0%
Low	40.0%
Healthcare devotion	
High	75.0%
Low	25.0%
Healthcare passion	
High	65.0%
Low	35.0%
Healthcare enthusiasm	
High	70.0%
Low	30.0%
Healthcare energy	
High	60.0%
Low	40.0%
Healthcare vigor	
High	75.0%
Low	25.0%
Healthcare dynamism	
High	65.0%
Low	35.0%
Healthcare flexibility	
High	70.0%
Low	30.0%
Healthcare adaptability	
High	60.0%
Low	40.0%
Healthcare resilience	
High	75.0%
Low	25.0%
Healthcare robustness	
High	65.0%
Low	35.0%
Healthcare stability	
High	70.0%
Low	30.0%
Healthcare consistency	
High	60.0%

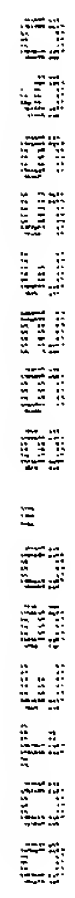


Table 1. Demographic characteristics of the study population	
Age (years)	65.0 ± 10.0
Gender	
Male	50.0%
Female	50.0%
Education (years)	12.0 ± 2.0
Marital status	
Married	70.0%
Single	30.0%
Income (USD/month)	1,500.0 ± 500.0
Health status	
Good	60.0%
Fair	40.0%
Poor	10.0%
Smoking status	
Smoker	30.0%
Non-smoker	70.0%
Alcohol consumption	
Drinker	20.0%
Non-drinker	80.0%
Comorbidities	
Hypertension	45.0%
Diabetes	35.0%
Cholesterol	55.0%
Arthritis	40.0%
Depression	25.0%
Medication use	
Yes	65.0%
No	35.0%
Healthcare access	
Good	75.0%
Fair	20.0%
Poor	5.0%

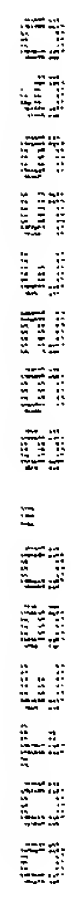


FIG.18

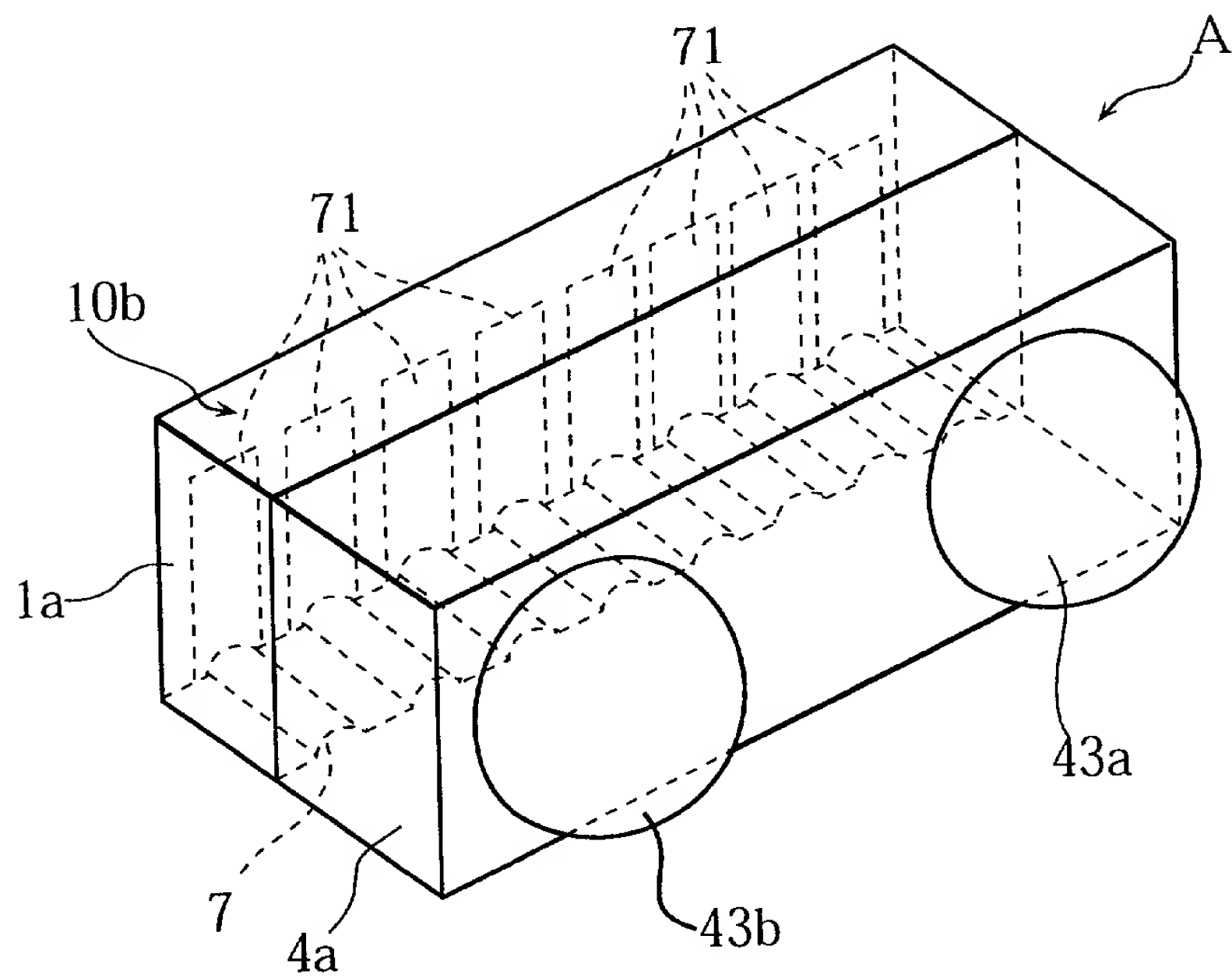


FIG.19

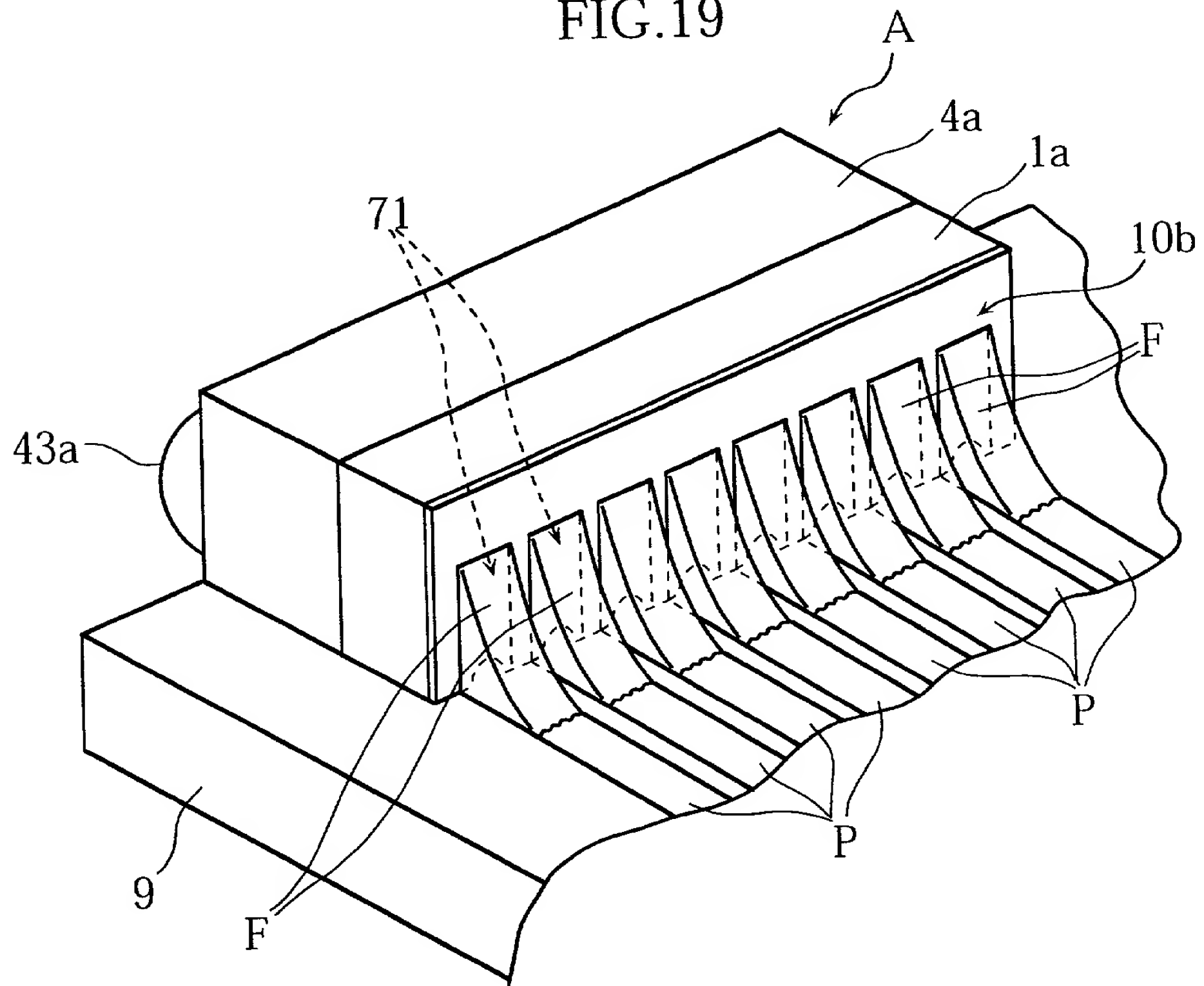


FIG.20
PRIOR ART

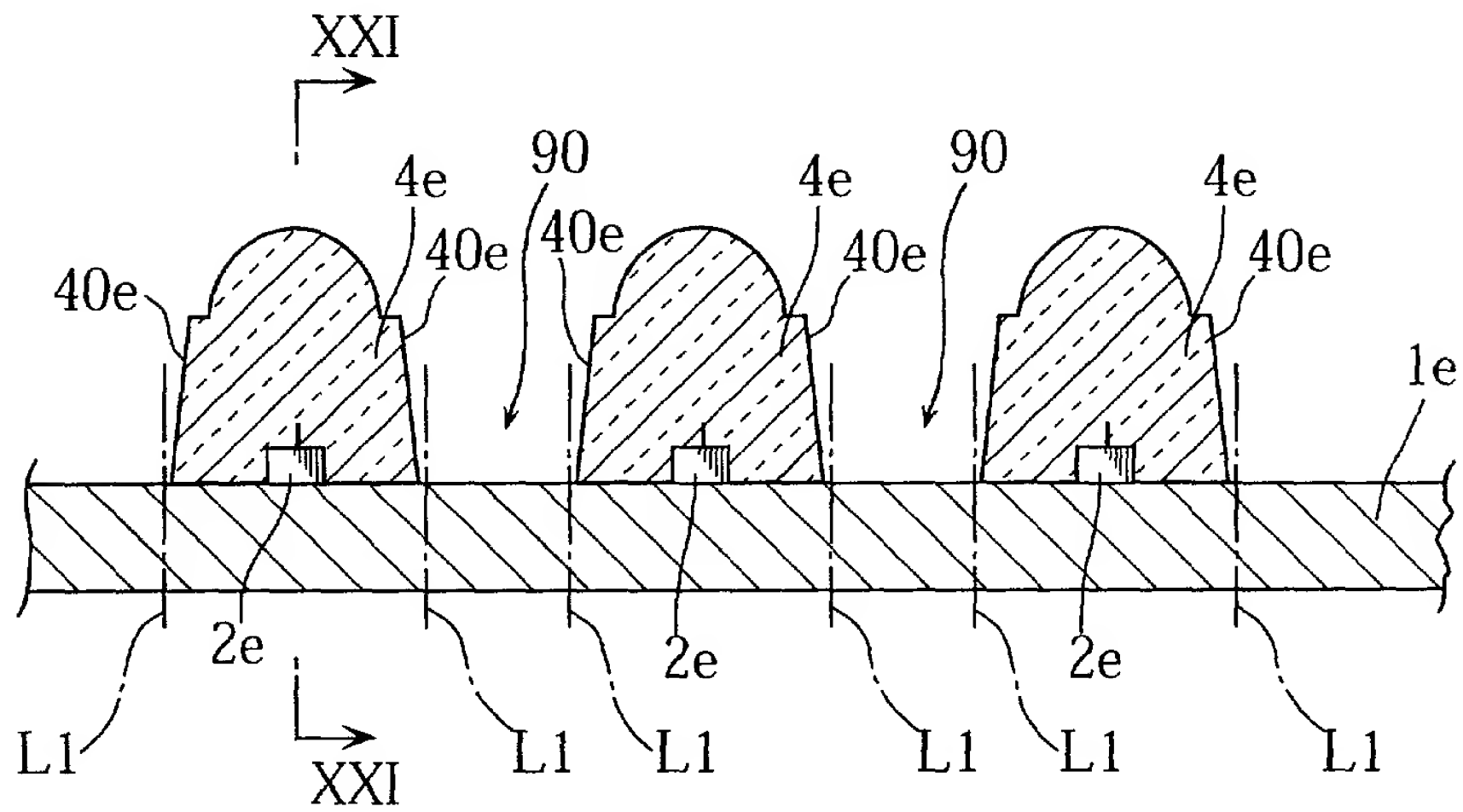


FIG.21
PRIOR ART

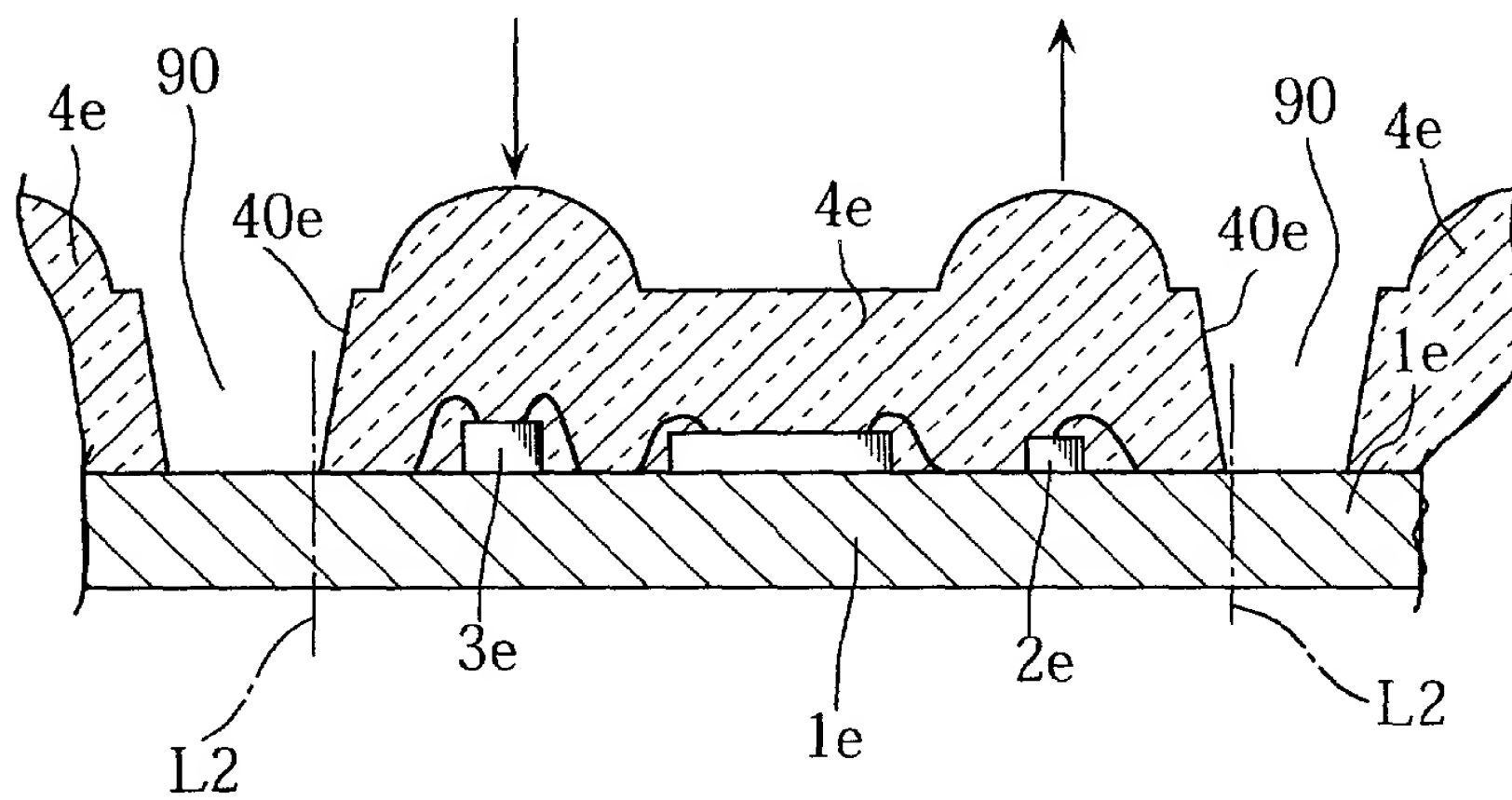


FIG.22
PRIOR ART

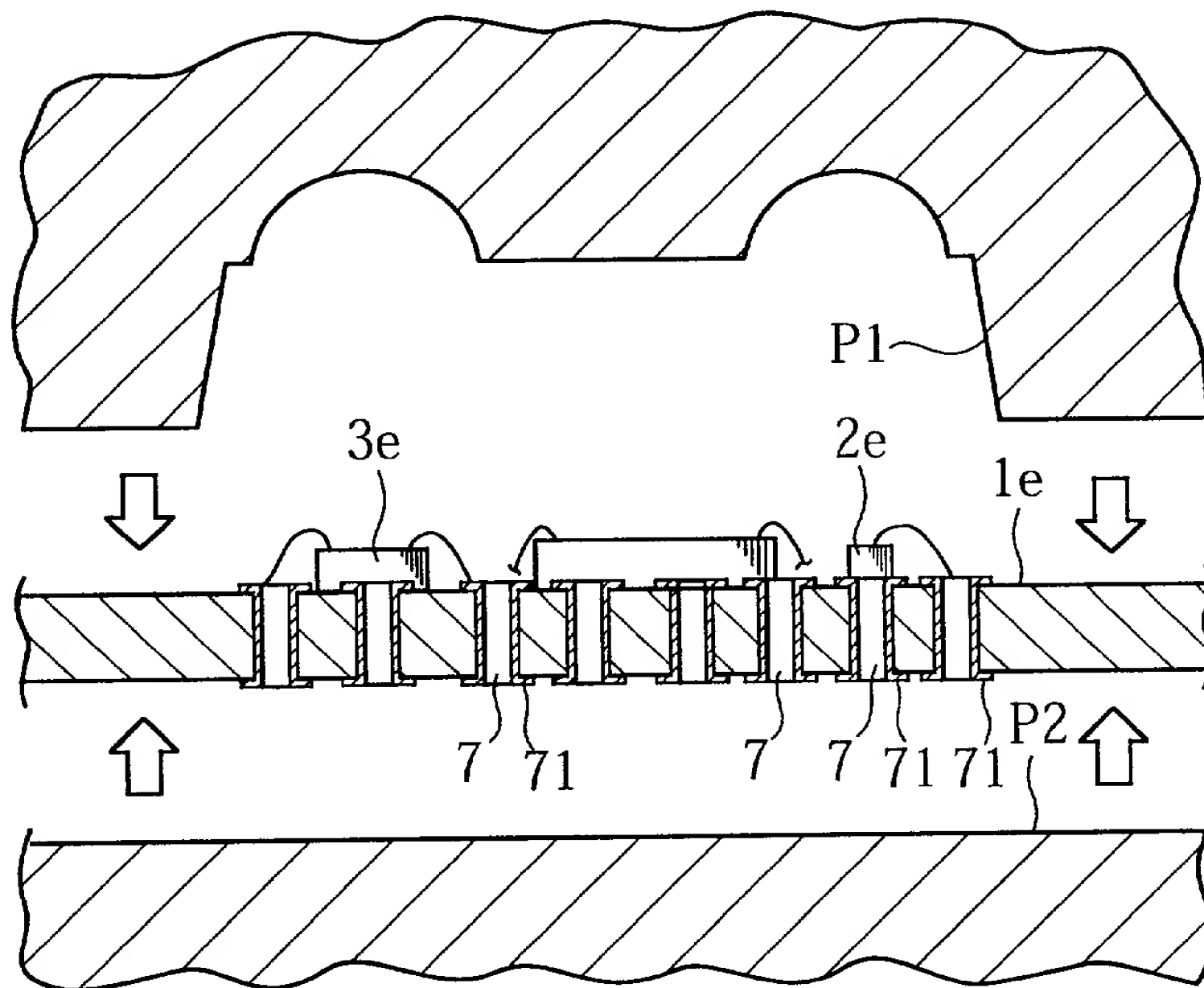
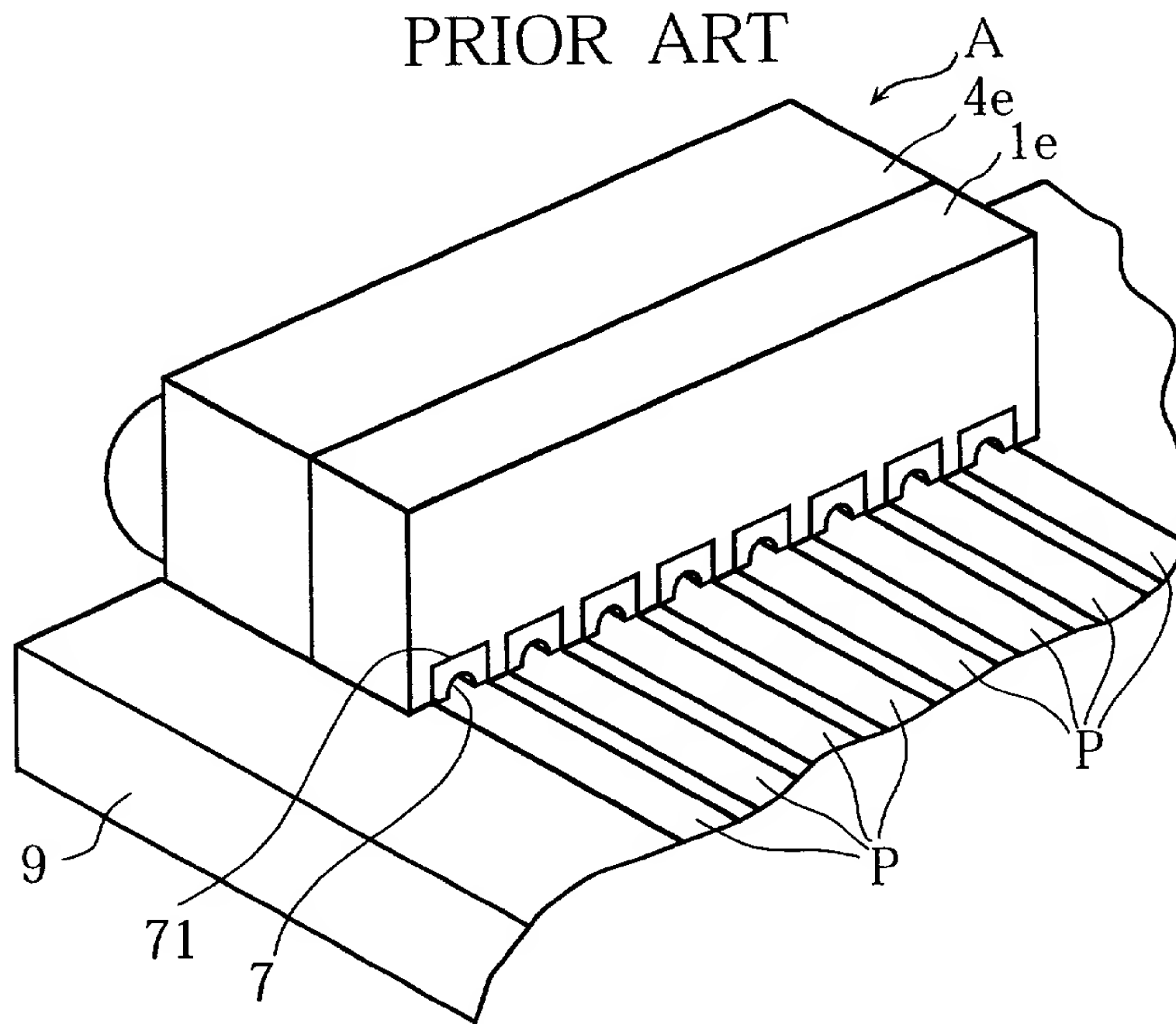


FIG.23
PRIOR ART



Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書

Japanese Language Declaration

私は、下欄に氏名を記載した発明者として、以下のとおり宣言する：

私の住所、郵便の宛先および国籍は、下欄に氏名に続いて記載したとおりであり、

名称の発明に関し、請求の範囲に記載した特許を求める主題の本来の、最初にして唯一の発明者である（一人の氏名のみが下欄に記載されている場合）か、もしくは本来の、最初にして共同の発明者である（複数の氏名が下欄に記載されている場合）と信じ、

☐ その明細書を
(該当する方に印を付す)

☐ ここに添付する。

☐ _____ 日に出願番号
第 _____ 号として提出し、
_____ 日に補正した。
(該当する場合)

☐ _____ 日に PCT 国際出願番号
第 _____ 号として提出し、
PCT 第19条に基づき _____ 日に補正した。
(該当する場合)

私は、前記のとおり補正した請求の範囲を含む前記明細書の内容を検討し、理解したことを陳述する。

私は、連邦規則法典第37部第1章第56条(a)項に従い、本願の審査に所要の情報を開示すべき義務を有することを認める。

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name,

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

INFRARED DATA COMMUNICATION MODULE
AND METHOD OF MAKING THE SAME

the specification of which
(check one)

☒ is attached hereto.

☐ was filed on _____ as
Application Serial No. _____
and was amended on _____
(if applicable)

☐ was described and claimed in PCT international application
No. _____ filed on _____
and as amended under PCT Article 19 on _____
(if applicable)

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to the examination of this application in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56(a).

Japanese Language Declaration

私は、合衆国法典第35部第119条 (a) - (d) 項または第365条 (a) - (b) 項にもとづく下記の外国特許出願または発明者証出願または少なくとも1つの合衆国以外の国を指定したPCT国際出願の外国優先権利益を主張し、さらに優先権の主張に係わる基礎出願の出願日前の出願日を有する外国特許出願または発明者証出願またはPCT国際出願を以下に明記する:

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, § 119(a)-(d) or § 365(a)-(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or of any PCT international application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate or PCT international application having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

Prior foreign applications

先の外国出願

(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出願の年月日)
Patent Application No. 11-245481	Japan	31/8/1999
Patent Application No. 11-254268	Japan	8/9/1999
Patent Application No. 11-256663	Japan	10/9/1999
(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出願の年月日)
(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出願の年月日)

Priority claimed

優先権の主張

<input checked="" type="checkbox"/> Yes あり	<input type="checkbox"/> No なし
<input checked="" type="checkbox"/> Yes あり	<input type="checkbox"/> No なし
<input checked="" type="checkbox"/> Yes あり	<input type="checkbox"/> No なし
<input type="checkbox"/> Yes あり	<input type="checkbox"/> No なし
<input type="checkbox"/> Yes あり	<input type="checkbox"/> No なし

私は、合衆国法典第35部第120条にもとづく下記の合衆国特許出願の利益または第365条 (c) 項にもとづく合衆国を指定するPCT国際出願の利益を主張し、本願の請求の範囲各項に記載の主題が合衆国法典第35部112条第1項に規定の態様で先の合衆国出願に開示されていない限度において、先の出願の出願日と本願の国内出願日またはPCT国際出願日の間に公表された連邦規則法典第37部第1章第56条 (a) 項に記載の所要の情報を開示すべき義務を有することを認める:

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 120 of any United States application(s), or § 365(c) of any PCT international application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT international application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose material information as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56(a) which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application:

(Application Serial No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(現況) (特許済み、係属中、放棄済み)	(Status) (patented, pending, abandoned)
------------------------------------	------------------------	-------------------------	--

(Application Serial No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(現況) (特許済み、係属中、放棄済み)	(Status) (patented, pending, abandoned)
------------------------------------	------------------------	-------------------------	--

Japanese Language Declaration

私は、ここに自己の知識にもとづいて行った陳述がすべて真実であり、自己の有する情報および信ずるところに従って行った陳述が真実であると信じ、さらに故意に虚偽の陳述等を行った場合、合衆国法典第18部第1001条により、罰金もしくは禁固に処せられるか、またはこれらの刑が併科され、またかかる故意による虚偽の陳述が本願ないし本願に対して付与される特許の有効性を損なうことがあることを認識して、以上の陳述を行ったことを宣言する。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

委任状：私は、下記発明者として、以下の代理人をここに選任し、本願の手続を遂行すること並びにこれに関する一切の行為を特許商標庁に対して行うことを委任する。
(代理人氏名および登録番号を明記のこと)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and /or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith. (*list name and registration number*)

Michael D. Bednarek, Regn. No. 32, 329

Lawrence J. Gotts, Regn. No. 31, 163

Aslan Baghdadi, Regn. No. 34, 542

Elizabeth M. Roesel, Regn. No. 34, 878

David C. Isaacson, Regn. No. 38, 500

書類の送付先：

Michael D. Bednarek
SHAW PITTMAN
2300 N Street, N.W.,
Washington, D.C. 20037-1138

Send Correspondence to:

Michael D. Bednarek
SHAW PITTMAN
2300 N Street, N.W.,
Washington, D.C. 20037-1138


直通電話連絡先：(名称及び電話番号)

Michael D. Bednarek at 202/663-8904

Direct Telephone Calls to: (*name and telephone number*)

Michael D. Bednarek at 202/663-8904

Japanese Language Declaration

唯一のまたは第一の発明者の氏名	Full name of sole or first inventor Tomoharu Horio	
同発明者の署名	Inventor's signature 	Date August 25, 2000
住所	Residence c/o ROHM CO., LTD. Kyoto, Japan	
国籍	Citizenship Japan	
郵便の宛先	Post Office Address c/o ROHM CO., LTD. 21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-8585 Japan	

第2の共同発明者の氏名 (該当する場合)	Full name of second joint inventor, if any	
同第2発明者の署名	Second Inventor's signature	Date
住所	Residence	
国籍	Citizenship	
郵便の宛先	Post Office Address	

第3の共同発明者の氏名 (該当する場合)	Full name of third joint inventor, if any	
同第3発明者の署名	Third Inventor's signature	Date
住所	Residence	
国籍	Citizenship	
郵便の宛先	Post Office Address	

第4の共同発明者の氏名 (該当する場合)	Full name of fourth joint inventor, if any	
同第4発明者の署名	Fourth Inventor's signature	Date
住所	Residence	
国籍	Citizenship	
郵便の宛先	Post Office Address	

第5の共同発明者の氏名 (該当する場合)	Full name of fifth joint inventor, if any	
同第5発明者の署名	Fifth Inventor's signature	Date
住所	Residence	
国籍	Citizenship	
郵便の宛先	Post Office Address	

明細書

赤外線データ通信モジュール及びその製造方法

5 技術分野

本発明は、いわゆる I r D A (Infrared Data Association) 方式を用いてデータ通信を行うための赤外線データ通信モジュールに関する。

背景技術

10 I r D A 方式における赤外線データ通信モジュールは、ノート型パーソナルコンピュータの分野において普及しており、最近では、携帯電話や電子手帳等にも用いられつつある。この赤外線データ通信モジュールは、赤外線 L E D、フォトダイオード及び変復調回路等がワンパッケージ化され、双方向にワイヤレス通信が可能とされたものである。

15 赤外線データ通信モジュールでは、赤外線データ通信機能の高性能化が進むなか、モジュール全体の形態は、ダウンサイジングによりますます小型化されている。そして、赤外線データ通信モジュールの製造プロセスにおいては、厳しい寸法精度が要求されるとともにコスト低減が望まれている。

図 2 0 及び図 2 1 は、従来の赤外線データ通信モジュールの製造方法の一例を示す図である。この従来の製造方法では、長尺状または長矩形状の基板 1 e の片面上に、赤外線を発する発光素子 2 e と赤外線を感知する受光素子 3 e とを複数組並べて搭載した後、これらを複数の樹脂パッケージ 4 e により封止する工程を有している。

この工程においては、発光素子 2 e と受光素子 3 e とを 1 組ずつ別個独立に樹脂封止するように、発光素子 2 e と受光素子 3 e との組み合わせ数と同等数の樹脂パッケージ 4 e を基板 1 e 上に形成している。このような樹脂封止工程の後、たとえば仮想線 L 1, L 2 に示す位置において基板 1 e を切断する。これにより、複数の赤外線データ通信モジュールが得られる。

しかしながら、上記従来の製造方法においては、次のような不具合を生じて

いた。

すなわち、従来においては、発光素子 2 e と受光素子 3 e とを一組として、その一組ごとにそれぞれ個別に樹脂パッケージ 4 e によって封止している。そのため、樹脂パッケージ 4 e の総数が多くなり、複数の樹脂パッケージ 4 e の相互間における隙間 9 0 の数も多くなる。よって、基板 1 e 上における無駄なスペースが大きくなる。その結果、一定のサイズの基板 1 e から製造される赤外線データ通信モジュールの取り数は少なくなる。したがって、赤外線データ通信モジュールの製造コストが高価となるといった不具合があった。

一方、本発明者は、上記不具合を解消する手段として、基板 1 e 上に搭載された複数組の発光素子 2 e と受光素子 3 e とを含む一群の部品を、1 つの樹脂パッケージによって一括して封止することを先に着想した。このような手段によれば、樹脂パッケージの数を最小数にし、従来において発生していた複数の樹脂パッケージの各間における無駄なスペース（隙間 9 0）を無くすることが可能である。

ところが、このような手段によれば、基板 1 e の片面の広い面積に対して樹脂パッケージが密着することとなる。そのため、上記手段においては、基板 1 e の厚みが小さい場合、あるいは基板 1 e の材質が比較的軟質であるような場合には、基板 1 e に反り変形を生じ、最終的に得られる赤外線データ通信モジュールの各部に歪みを生じさせるおそれがあった。

また、発光素子 2 e と受光素子 3 e とを樹脂パッケージ 4 e により封止する工程では、図 2 2 に示すように、基板 1 e の表面に樹脂成形用の金型 P 1, P 2 を用いて樹脂パッケージ 4 e が形成される。具体的には、基板 1 e の表面には、樹脂パッケージ 4 e の形状に応じたかたちの表面用の金型 P 1 が圧接され、基板 1 e の裏面には、平坦な押圧面を有する裏面用の金型 P 2 が圧接される。これにより、基板 1 e の表面側においては、表面用の金型 P 1 と基板 1 e との間に充填された樹脂が固化して樹脂パッケージ 4 e が形成される。一方、基板 1 e の裏面側には、裏面用の金型 P 2 が基板 1 e の裏面全体に面して密着した状態とされる。

ところが、基板 1 e には、その厚み方向に貫通するスルーホール 7 が形成され、基板 1 e の裏面には、スルーホール 7 の開口部に繋がる端子部 7 1 が形成さ

れる。この端子部 7 1 は、極めて薄膜の導体といえども厚みを有する。そのため、基板 1 e の裏面にわずかな起伏を生じる場合があり、これにより、裏面用の金型 P 2 と基板 1 e との密着性が悪くなるときがある。すなわち、基板 1 e の裏面側におけるスルーホール 7 付近の面圧が不十分となり、特に裏面側の基板 1 e と金
5 型 P 2 に隙間が生じる。このような隙間が生じた状態で表面用の金型 P 1 と基板 1 e との間に樹脂を充填すると、基板 1 e の表面側にあるべき樹脂がスルーホール 7 を通じて基板 1 e の裏面側へと回り込んでしまうことがある。そのため、基板 1 e の裏面側に不要な樹脂が付着してしまうおそれがあった。

また、上記製造工程においては、上記した樹脂封止工程や分割工程の前には、
10 基板 1 e の表面及び裏面に所定の導体パターン（図示せず）や端子部 7 1 が形成される。これには、たとえば、フォトリソグラフィ法が用いられる。すなわち、表面に銅箔を施した基板 1 e に対してレジスト材料を塗布し、所望のパターンが形成されたマスクを用いて露光・現像をした後、エッチングによって銅箔の不要部分を除去する。

15 そして、基板 1 e の表面は、「グリーンレジスト」と呼称される絶縁層（図示せず）によって、導体パターン及び端子部 7 1 の露出するべき以外の領域が覆われる。この絶縁層を形成する場合にも、上記したように露光用のマスクが用いられる。この場合、マスクの装着位置がずれていると、導体パターンや端子部 7 1 の露出される部分が小さくなることがあった。

20 ここで、赤外線データ通信モジュール A は、図 2 3 に示すように、これを実装するためのモジュール実装基板 9 に実装される場合、たとえば、基板 1 e の裏面がモジュール実装基板 9 の表面に対して直交方向に沿うように実装される。このとき、裏面の端子部 7 1 と、モジュール実装基板 9 の表面に形成された配線パターン P とがハンダ付けにより接合される。

25 しかしながら、上記したように端子部 7 1 の露出部分が小さければ、ハンダ付けによるハンダフィレットが十分に形成されにくくなり、あるいは形成されても剥がれやすくなる。そのため、赤外線データ通信モジュールの端子部 7 1 とモジュール実装基板 9 の配線パターン P との接合は、確実になされないおそれがあった。

発明の開示

本発明の課題は、上記した問題を解消あるいは少なくとも低減しうる赤外線データ通信モジュールの製造方法、及び赤外線データ通信モジュールを提供することにある。

- 5 本発明の第1の側面により提供される赤外線データ通信モジュールの製造方法は、基板の表裏面に所定の配線パターンを形成するパターン形成工程と、上記基板の片面上に複数組の発光素子と受光素子とを含む一群の部品を搭載する搭載工程と、上記基板上に搭載された上記一群の部品を樹脂封止する封止工程と、上記樹脂封止がなされた一群の部品を、上記発光素子と上記受光素子とが1組ずつ
10 の組み合わせとされた複数の赤外線データ通信モジュールとして分割する分割工程と、を有している、赤外線データ通信モジュールの製造方法であって、上記封止工程においては、上記一群の部品を封止する樹脂を、互いに分離した複数の樹脂パッケージとして形成し、かつこれら複数の樹脂パッケージのそれぞれにより、上記発光素子と上記受光素子とを2組以上一括して封止する方法である。

- 15 この製造方法によれば、樹脂パッケージの総数を発光素子および受光素子のそれぞれの組み合わせ数よりも少なくすることができる。したがって、基板上において無駄なスペースとなる複数の樹脂パッケージどうしの間の隙間の数を少なくし、そのトータルの面積を小さくすることができる。その結果、本発明においては、従来と比較すると、同一サイズの基板から製造される赤外線データ通信モ
20 ジュールの取り数を多くすることができる。したがって、赤外線データ通信モジュールの製造コストの低減化を図ることが可能となる。

- さらに、本発明においては、基板の片面上の一群の部品を1つの樹脂パッケージで一括して封止する手段とは異なり、複数の樹脂パッケージの各間には適度な隙間が形成され、基板の片面には樹脂パッケージが密着していない領域が設けら
25 れる。したがって、基板の片面に樹脂パッケージを形成することに起因して基板に反り変形が生じることを適切に防止し、または抑制することもできる。その結果、各部に歪みが無い品質の良好な赤外線データ通信モジュールを製造することができる。

 本発明の好適な実施例によれば、上記搭載工程においては、複数組の発光素

子と受光素子とを、上記基板の片面上において縦横のそれぞれの方向に複数列ずつ配列し、上記封止工程においては、上記縦横のいずれの方向においても上記樹脂パッケージを複数ずつ並ぶように形成する。

この製造方法によれば、基板が上記縦横のいずれの方向においても反り変形を生じ難くすることができる。したがって、最終的に製造される赤外線データ通信モジュールの品質を一層高めることができる。

本発明の別の好適な実施例によれば、上記基板は、一定方向に延びる帯状または長矩形状であるとともに、上記基板には、その短手方向に延びる複数のスリットが上記基板の長手方向に間隔を隔てて設けられており、かつ上記基板の片面のうち、上記複数のスリットの各間の領域に、上記一群の部品が搭載されている。

この製造方法によれば、上記基板は、上記複数のスリットが設けられている箇所においてその長手方向に部分的に撓み変形し易くなる。したがって、基板の片面上のうち、2つのスリットの間の領域に搭載されている一群の部品を樹脂封止したときに、仮にその領域において基板を反り変形させようとする応力が発生したとしても、その応力については、上記基板を上記スリットが設けられている箇所において部分的に変形させることにより吸収させることが可能となる。その結果、上記基板の長手方向のうち、上記樹脂封止された領域とはスリットを介して隔てた隣りの領域には、上記応力が直接大きな影響を及ぼさないようにすることができる。そのため、一群の部品が搭載されている領域において、基板が反り変形することを一層確実に防止することが可能となる。

本発明の別の好適な実施例によれば、上記パターン形成工程においては、上記基板の裏面に、上記基板の厚み方向に貫通するスルーホールに接続される端子部を形成するとともに、上記端子部と同等の厚みを有するダミーパターンを形成する。

この製造方法によれば、基板の裏面に、スルーホールに接続される端子部と同等の厚みを有するダミーパターンが形成され、このダミーパターンは、形成された部分が他の部分よりも厚手となる。そのため、基板の表裏面が樹脂封止するための金型に圧接されても、ダミーパターンが設けられた部分には、金型により付与される面圧が十分となる。したがって、たとえ基板の表面側からスルーホー

ル内に樹脂が流れ込んでも、基板の裏面側においては、スルーホール付近を含むダミーパターン全体が金型に強く密着する。よって、スルーホールを通じた基板の裏面側への樹脂の回り込みを十分に防ぐことができる。

- 5 本発明の別の好適な実施例によれば、上記パターン形成工程においては、上記基板の裏面に、上記基板の厚み方向に貫通するスルーホールに接続するとともに、外部の実装基板に接合し、かつ略矩形状に延びるように端子部を形成する。

- 10 この製造方法によれば、たとえば、フォトリソグラフィ法により、基板の裏面を、端子部を露出させるようにして絶縁層で覆う場合、端子部は略矩形状に延びて形成されるので、露光用のマスクの位置が多少ずれても、端子部の長手方向においてはこのずれ分を吸収することができる。そのため、外部の実装基板との接合において十分に接合範囲を露出させることができ、端子部を外部の実装基板と良好に接合させることができる。

本発明の第2の側面により提供される赤外線データ通信モジュールは、

- 15 基板の表裏面に所定の配線パターンを形成し、上記基板の片面上に搭載された複数組の発光素子と受光素子とを含む一群の部品を樹脂封止し、上記樹脂封止がなされた一群の部品を、上記発光素子と上記受光素子とが1組ずつの組み合わせとされた複数の赤外線データ通信モジュールとして分割することにより製造される、赤外線データ通信モジュールであって、上記一群の部品を封止する樹脂を、互いに分離した複数の樹脂パッケージとして形成し、かつこれら複数の樹脂パッ
20 ケージのそれぞれにより、上記発光素子と上記受光素子とを2組以上一括して封止することにより製造されたものである。

この構成によれば、本発明の第1の側面によって得られるのと同様な効果が期待できる。

- 25 本発明の好適な実施例によれば、上記基板には、その厚み方向に貫通するスルーホールが形成され、上記基板の裏面には、上記スルーホールと接続された端子部が形成されるとともに、上記端子部の厚みと同等の厚みを有するダミーパターンが形成されている。

好ましくは、上記基板の表面には、発光素子及び受光素子の組を各組ごとに区画化して搭載するための個別エリアが形成され、上記個別エリア内には、配線

パターンが形成され、上記ダミーパターンは、上記配線パターンに対極し、かつ上記配線パターンの全体的形状に対応して形成されている。

この構成によれば、基板の表面側における個別エリアには、部分的に厚みを有して配線パターンが設けられる。その一方で、基板の裏面側には、上記配線パターンに対応して部分的に厚みを有するダミーパターンが設けられる。そのため、金型による面圧が十分高められ、基板と金型との密着性がより良好に保たれる。したがって、各個別エリアにおいて良好な樹脂封止が行われ、赤外線データ通信モジュールを各個別エリアごとに確実に形成することができる。

本発明の別の好適な実施例によれば、上記基板には、その厚み方向に貫通するスルーホールが形成され、上記基板の裏面には、上記スルーホールに接続され、かつ外部の実装基板に接合するための端子部が設けられ、上記端子部は、略矩形状に延びて形成されている。

この構成によれば、赤外線送受信モジュールが外部の実装基板に実装されて、裏面の端子部と実装基板の配線パターンとが半田付けされる場合、半田フィレットを十分に付着した状態に形成でき、両者を堅固に接合させることができる。したがって、赤外線送受信モジュールの外部の実装基板に対する実装強度を向上させることができる。

本発明の別の好適な実施例によれば、上記基板は、その裏面が上記実装基板の表面に対して直交するように実装される場合、上記端子部は、上記実装基板の表面に対して凸となる方向に延びて形成される。

この構成によれば、基板の裏面において、その長手方向は外部の実装基板の配線パターンの幅が限られているため、その方向に端子部を延ばすことには限界がある。しかし、外部の実装基板の表面に対して凸となる方向には、短手方向における基板の幅だけ、可能な限り端子部を延ばすことができる。したがって、半田フィレットをより十分に付着した状態に形成できる。

本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によって、より明らかとなろう。

図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の第 1 実施例に基づく赤外線データ通信モジュールの製造方法に用いられる基板を示す斜視図である。

図 2 は、図 1 の基板を裏面側から見た斜視図である。

図 3 は、図 1 の III-III 方向に見た断面図である。

5 図 4 は、図 1 の IV-IV 方向に見た断面図である。

図 5 は、搭載部品が実装された基板の斜視図である。

図 6 は、図 5 の VI-VI 方向に見た断面図である。

図 7 は、図 5 の VII-VII 方向に見た断面図である。

図 8 は、赤外線データ通信モジュールの封止工程を示す斜視図である。

10 図 9 は、樹脂パッケージが形成された基板を示す斜視図である。

図 10 は、図 9 の X-X 方向に見た断面図である。

図 11 は、図 9 の XI-XI 方向に見た断面図である。

図 12 は、赤外線データ通信モジュールの切断工程を示す断面図である。

図 13 は、赤外線データ通信モジュールの切断工程を示す断面図である。

15 図 14 は、赤外線データ通信モジュールの実装形態を示す断面図である。

図 15 は、図 14 の XV-XV 方向に見た断面図である。

図 16 は、赤外線データ通信モジュールの側面図である。

図 17 は、赤外線データ通信モジュールの実装形態を示す断面図である。

20 図 18 は、本発明の第 2 実施例に基づく赤外線データ通信モジュールを示す斜視図である。

図 19 は、図 18 に示す赤外線データ通信モジュールの実装形態を示す斜視図である。

図 20 は、従来の赤外線データ通信モジュールの製造方法に用いられる基板を示す断面図である。

25 図 21 は、図 20 の XXI-XXI 方向に見た断面図である。

図 22 は、従来の赤外線データ通信モジュールの製造方法に用いられる基板と金型とを示す断面図である。

図 23 は、従来の赤外線データ通信モジュールの実装形態を示す斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の好ましい実施例を、添付の図面を参照して具体的に説明する。
なお、これらの図面を通じて同じあるいは類似の部材は、同じ参照記号によって示している。

まず、図1～図13を参照して説明する。これらの図は、本発明の第1実施例に基づく赤外線データ通信モジュールの製造方法の一例を示している。赤外線データ通信モジュールを製造するには、図1及び図2に示すような基板1を用いる。なお、図1は、基板1の表面側を表した図であり、図2は、基板1の裏面側を表した図である。

基板1は、たとえばガラスエポキシ樹脂製であり、一定方向に延びる帯状または長矩形状を有している。基板1には、その長手方向に一定の間隔を隔てて複数のスリット18が設けられている。複数のスリット18は、基板1の幅方向（短手方向）に延びた細幅状のものである。基板1の表面10aのうち、複数のスリット18の各間における一定領域には、後述する一群の部品を搭載するための部品搭載領域Sが規定されている。そして、各部品搭載領域Sには、複数の個別エリア19が設けられ、各個別エリア19を囲むように導電層10が形成されている。

複数の個別エリア19は、それぞれ長矩形状であり、縦横となる基板1の長手方向及び短手方向に適当な間隔で複数列に並んでいる。複数の個別エリア19には、1つの赤外線データ通信モジュールを製造するのに必要とされる配線パターン（その一部は図示略）70が形成されている。この配線パターン70は、後述する発光素子、受光素子、LSIチップを搭載するためのパッド部や、電極部等を有するものである。なお、図1では、パッド部のみが示されている。

一方、基板1の裏面10bには、図2に示すように、上記個別エリア19と対極するようにダミーエリア21が形成されている。ダミーエリア21は、その個別エリア19と同じ大きさに形成されている。ダミーエリア21の周囲には、導電層20が形成されている。ダミーエリア21内には、ダミーパターン22が設けられている。ダミーパターン22は、個別エリア19内における配線パターン70の全体面積と同程度の大きさを有している。ダミーパターン22は、基板

1の厚み方向に導電層20と同程度の厚みを有している。

基板1の表面10aにおける個別エリア19は、図3及び図4に示すように、表面10a全体に導電層10を薄膜形成した後、個別エリア19に相当する矩形区画領域をエッチング処理等で除去して形成される。このエッチング処理等の際、

5 個別エリア19内には、配線パターン70としての導電層10が残される。

一方、基板1の裏面10bにおけるダミーエリア21は、上記個別エリア19と同様に、基板1の裏面10b全体に導電層20を薄膜形成した後、ダミーエリア21に相当する矩形区画領域をエッチング処理等で除去して形成される。このエッチング処理等の際、ダミーエリア21内には、ダミーパターン22としての

10 の導電層20が残される。したがって、基板1の裏面10b側は、導電層20及び多数のダミーパターン22によって全体的に起伏の少ない面となる。

また、上記配線パターン70は、基板1の短手方向に並んだ複数のスルーホール7に接続されている。複数のスルーホール7は、基板1の厚み方向に貫通している。スルーホール7の各内周壁の導電膜7aは、基板1の裏面10bに形成された複数の端子部71と繋がっている。また、端子部71は、基板1の裏面10bにおいて導電層20に繋がっている。

15

各個別エリア19には、図5～図7に示すように、上記配線パターン70のパッド部に対して、発光素子2、受光素子3及びLSIチップ6が1組としてそれらが搭載される。発光素子2は、たとえば赤外線発光ダイオードからなる。受光素子3は、たとえば赤外線を感知可能なPINフォトダイオードからなる。LSIチップ6は、発光素子2及び受光素子3による赤外線の送受信動作を制御するものである。具体的には、LSIチップ6は、変復調回路や波形整形回路等が具備されている。1組の発光素子2、受光素子3及びLSIチップ6は、基板1の短手方向に1列に配列される。

20

さらに、発光素子2、受光素子3及びLSIチップ6は、配線パターン70の電極部に対してワイヤボンディングにより接続される。そして、発光素子2、受光素子3、及びLSIチップ6は、配線パターン70を介してスルーホール7と電氣的に接続された状態とされる。

25

次いで、基板1に対して上記した所定の部品を搭載した後、上記部品を樹脂

封止する。この樹脂封止作業は、図 8 及び図 9 に示すように、基板 1 の表面 1 0 a における各部品搭載領域 S に、互いに分離した複数の樹脂パッケージ 4 を形成して行う。各樹脂パッケージ 4 は、たとえば顔料を含んだエポキシ樹脂からなる。各樹脂パッケージ 4 は、可視光に対しては透光性を有しない反面、赤外線については十分に良好な透光性を有するものである。

より詳細には、各樹脂パッケージ 4 は、図 8 に示すように、表面用及び裏面用の金型 P 1, P 2 を用いてたとえばトランスファモールド法により成形される。すなわち、表面用の金型 P 1 には、樹脂パッケージ 4 の形状に応じたキャビティ部 4 a を有するものが用いられる。また、裏面用の金型 P 2 には、基板 1 の裏面側に面して平坦な押圧面 P 2 a を有するものが用いられる。

表面用の金型 P 1 におけるキャビティ部 4 a は、基板 1 の幅方向に沿う各列がゲート（図示せず）を介して空間を共有するように繋がられている。そして、表面用の金型 P 1 は、各キャビティ部 4 a が個別エリア 1 9 の 2 つ分を包囲するように、基板 1 の表面 1 0 a 上において正確に位置合わせされる。一方、裏面側の金型 P 2 は、基板 1 の裏面 1 0 b 全体を押圧する。

基板 1 は、両金型 P 1, P 2 の間において、両者によって押圧保持される。そして、ランナー 4 b を通じてキャビティ部 4 a 内に樹脂が注入された後、樹脂が硬化してから両金型 P 1, P 2 を開くことにより図 9 に示す成形品を得る。

こうして成形された各樹脂パッケージ 4 は、図 1 0 及び図 1 1 に示すように、基板 1 の表面 1 0 a から上方に傾斜して起立した複数の側面 4 0 を有している。また、各樹脂パッケージ 4 は、複数の側面 4 0 の上端 4 2 に繋がった天井面 4 1 を有している。複数の側面 4 0 は、表面用の金型 P 1 におけるキャビティ部 4 a に抜き勾配が設けられていることに起因して、それらのいずれもが傾斜面となっている。

天井面 4 1 は、発光素子 2 及び受光素子 3 の上方に位置している。この天井面 4 1 には、その一部分を上向きの半球状に膨出させた一対のレンズ 4 3 a, 4 3 b が設けられている。これら一対のレンズ 4 3 a, 4 3 b は、発光素子 2 の発光特性及び受光素子 3 の受光特性に指向性を付与するためのものである。

上記のように、各樹脂パッケージ 4 を形成する場合、基板 1 の長手方向にお

いては、互いに隣り合う 2 つの個別エリア 19 上に搭載されている 2 組の（2 つずつの）発光素子 2、受光素子 3 及び L S I チップ 6 を一括して封止する。したがって、図 9 に示すように、1 つの部品搭載領域 S において、発光素子 2、受光素子 3 及び L S I チップ 6 の組み合わせが、基板 1 の長手方向において計 8 組設
5 けられている場合には、その方向に計 4 つの樹脂パッケージ 4 が並んで形成されることとなる。また、それら計 4 つの樹脂パッケージ 4 の各間には、適当な幅の隙間 9 2 が計 3 箇所形成される。

一方、基板 1 の幅方向においては、発光素子 2、受光素子 3 及び L S I チップ 6 の 1 組分に相当する領域を 1 つの樹脂パッケージ 4 によって封止するように、
10 複数の樹脂パッケージ 4 を形成する。この場合、それら複数の樹脂パッケージ 4 の間には、適当な幅の隙間 9 3 が形成される。

このように、複数の樹脂パッケージ 4 の形成工程によれば、複数の樹脂パッケージを 1 つの個別エリア 19 ごとに独立させて形成する場合と比較すると、基板 1 の長手方向における隙間 9 2 の総数を少なくすることができる。このため、
15 隙間 9 2 の総数が少なくなる分だけ基板 1 上の無駄なスペースを少なくし、基板 1 の長手方向における赤外線データ通信モジュールの取り数を増加させることが可能となる。また、基板 1 の長手方向及び短手方向において、隙間 9 2、9 3 が適当数設けられていれば、基板 1 の表面 10 a に各樹脂パッケージ 4 が密着して設けられることにより、基板 1 がその長手方向や短手方向に大きく反り変形しない
20 ようにすることができる。

また、上記した樹脂封止作業は、図 8 及び図 9 に示したように、基板 1 の長手方向に設けられている複数の部品搭載領域 S のそれぞれに対して順次行う。その一方、複数の部品搭載領域 S どうしは、スリット 18 によって仕切られた構成となっている。そのため、スリット 18 が設けられている箇所において、基板 1
25 が部分的に曲げ変形を生じ易くなっている。これにより、1 つの部品搭載領域 S に仮に基板 1 を曲げる力が発生したとしても、この力はスリット 18 が設けられている領域の基板 1 の曲げ変形によって吸収緩和される。

したがって、1 つの部品搭載領域 S に発生した基板 1 に対する曲げ力が、その隣の部品搭載領域 S に直接大きく影響しないようにすることができる。よって、

各部品搭載領域 S において基板 1 が反り変形することを一層確実に防止することができる。

なお、樹脂パッケージ 4 を形成して発光素子 2 や受光素子 3 を封止する場合には、それらの 2 組を一括して封止するのに代えて、3 組を一括して、あるいはそれ以上の組数の発光素子 2 及び受光素子 3 を一括して封止してもかまわない。本発明においては、1 つの樹脂パッケージによって封止される発光素子 2 及び受光素子 3 の組合せ数を増やすほど、複数の樹脂パッケージ 4 の相互間に形成される隙間の数を減らすことができ、1 つの成形品から取り出される赤外線データ通信モジュールの単品数を増加させることが可能である。

ここで、このような樹脂パッケージ 4 の成形の際、個別エリア 19 上にある樹脂は、図 10 に示すように、スルーホール 7 を通じて基板 1 の裏面 10 b 側に回り込む可能性がある。あるいは、各スルーホール 7 内には、その開口部を適当なレジスト膜（図示せず）によって塞ぐことにより、樹脂が流入しない形態とされた場合でも、レジスト膜が高温の樹脂とともに熔融するときがある。そうすると、樹脂が基板 1 の裏面 10 b 側にスルーホール 7 を通じて回り込む可能性がある。

しかしながら、基板 1 の裏面 10 b 側には、スルーホール 7 の端子部 71 に加えて、それと同じ厚みを有するダミーパターン 22 が設けられているため、起伏の少ない平坦な面となっている。

したがって、両金型 P1, P2 が基板 1 を押圧する状態では、個別エリア 19 とダミーエリア 21 とにおける面圧が十分高められる。そして、裏面用の金型 P2 の押圧面 P2a（図 8 参照）が基板 1 の裏面 10 b 上におけるスルーホール 7 付近の端子部 71 やダミーパターン 22 に隙間なくぴったりと密着した状態となる。すなわち、スルーホール 7 は、基板 1 の裏面 10 b において金型 P2 の平坦な押圧面 P2a によって確実に塞がれる。そのため、たとえ基板 1 の表面 10 a 側からスルーホール 7 内に樹脂が流れ込んだとしても、裏面 10 b 側においては、スルーホール 7 外に樹脂が溢れることはない。したがって、樹脂の回り込みを防止でき、基板 1 の裏面 10 b 側に樹脂が付着することがなくなる。

次に、上記樹脂封止作業を終了した後には、図 12 及び図 13 に示すように、

基板 1 及び複数の樹脂パッケージ 4 をそれらの厚み方向に切断し、基板 1 や基板 1 上の搭載部品を複数の赤外線データ通信モジュールとして分割するための作業を行う。切断作業は、基板 1 の長手方向と短手方向とのそれぞれの方向において行う。

- 5 基板 1 の長手方向においては、たとえば図 1 2 の仮想線 L a ～L d で示す箇所を、駆動回転自在な円板状のブレード 5 を用いて切断する。仮想線 L a ～L d は、いずれも樹脂パッケージ 4 の天井面 4 1 を通過しており、天井面 4 1 の幅方向両端部を通過する仮想線 L a , L d は、側面 4 0 の上端 4 2 よりも適当な寸法 S a だけ樹脂パッケージ 4 の幅方向内方寄りである。したがって、これらの仮想線 L a , L d の位置において樹脂パッケージ 4 及び基板 1 を切断すれば、各樹脂パッケージ 4 から傾斜した側面 4 0 が除去されることとなる。複数のスルーホール 7 は、仮想線 L a 上に位置しており、基板 1 が切断されるときにそれら複数のスルーホール 7 は分割される。

- 15 仮想線 L b , L c は、各樹脂パッケージ 4 の幅方向の略中央部を通過している。これら仮想線 L b , L c の位置を切断すれば、各樹脂パッケージ 4 によって封止された 2 組の発光素子 2、受光素子 3 及び L S I チップ 6 が 1 組ずつの組み合わせに分断されることとなる。仮想線 L c 上にも複数のスルーホール 7 が位置しており、複数のスルーホール 7 も基板 1 が切断されることによって分割される。

- 20 なお、切断用のブレード 5 の厚み t を、仮想線 L b , L c の幅と同一の寸法にしておけば、1 回の切断作業により、2 つの仮想線 L b , L c の位置の切断を同時に行うことができる。そのため、切断作業の工程数を少なくすることができる。

- 25 基板 1 の短手方向においては、たとえば図 1 3 の仮想線 L e の位置で樹脂パッケージ 4 及び基板 1 を切断する。この切断作業は、たとえば図 1 2 に示した仮想線 L a , L d の位置を切断する場合と同様に、樹脂パッケージ 4 から傾斜した側面 4 0 を除去するように、樹脂パッケージ 4 をその天井面 4 1 を通過する位置で切断する作業である。

 なお、本実施例においては、樹脂パッケージ 4 の複数の傾斜した側面 4 0 の全部または一部をそのまま残すように基板 1 を切断してもかまわない。たとえば、

図 1 3 において、仮想線 L e の位置で樹脂パッケージ 4 と基板 1 とを切断するの
に代えて、仮想線 L g で示す位置において基板 1 のみを切断してもかまわない。

上述した一連の作業工程によれば、図 1 4 ～図 1 6 に示す構成の赤外線デー
タ通信モジュール A が複数個製造されることとなる。この赤外線データ通信モ
ジュール A は、矩形状に切断された基板 1 a 上に、発光素子 2、受光素子 3 及び
L S I チップ 6 のそれぞれが 1 つずつ搭載され、かつこれらがその四方を切断さ
れた樹脂パッケージ 4 a によって封止された構造となっている。

樹脂パッケージ 4 a では、基板 1 a の表面から傾斜して起立していた複数の
側面 4 0 がいずれも除去されている。樹脂パッケージ 4 a の複数の側面 4 0 a は、
いずれも滑らかな平面状の切断面であり、基板 1 a の切断面 1 1 と面一となっ
ている。したがって、赤外線データ通信モジュール A の複数の外面としては、切断
面 1 1 と側面 4 0 a とが面一状に繋がった 2 つずつの平面 8 A、8 B となる。各
平面 8 A は、この赤外線データ通信モジュール A の長手方向に延びており、各平
面 8 B はそれと直交する面である。1 つの平面 8 A には、複数のスルーホール 7
が分割されることによって形成された複数の凹部 7 A が設けられている。凹部 7
A では、複数の端子部 7 1 に繋がったそれらの導体膜 7 a が外部に露出した構造
となっている。

上記構成の赤外線データ通信モジュール A は、既述したとおり、基板 1 a の
原型品とされていた基板 1 に大きな反り変形が生じないようにして製造されたも
のである。したがって、この赤外線データ通信モジュール A は、基板 1 a 上に搭
載されている発光素子 2、受光素子 3 及び L S I チップ 6 のそれぞれのボンディ
ング部分や、それらに繋がった金線等のワイヤのボンディング部分に大きな歪み
等が生じていないものとなり、その品質は良好である。

赤外線データ通信モジュール A の使用態様としては、たとえば次の 2 通りの
使用態様がある。第 1 の使用態様は、図 1 4 に示すように、赤外線データ通信モ
ジュール A をその基板 1 a の裏面 1 0 b が下向きになるようにして、モジュール
実装基板 9 上に実装する態様である。

この実装は、たとえばハンダリフローの手法を用いて行うことができ、基板
1 a の裏面 1 0 b の端子部 7 1 をモジュール実装基板 9 の端子 9 4 にハンダを介

して接合すればよい。ハンダは、端子部 7 1 のみならず、各凹部 7 A の導体膜 7 a にも接触させることができる。したがって、モジュール実装基板 9 に対する赤外線データ通信モジュール A の実装強度を十分なものにできる。この第 1 の使用態様においては、モジュール実装基板 9 の表面に直交する方向（図面では上下方向）に赤外線の送受信を行うことができる。

図 1 7 は、赤外線データ通信モジュール A の第 2 の使用態様を示している。この態様においては、赤外線データ通信モジュール A をその 1 つの平面 8 A が下向きとなる姿勢とし、各凹部 7 A の導体膜 7 a がモジュール実装基板 9 上の端子 9 4 に対面するようにして実装される。平面 8 A は、基板 1 a の厚みの幅と、樹脂パッケージ 4 a のレンズ 4 3 a, 4 3 b を除く部分の厚みの幅とを合計した幅広な面である。そのため、赤外線データ通信モジュール A をモジュール実装基板 9 上において安定的に載置しておくことができる。

したがって、ハンダリフローの手法を用いて赤外線データ通信モジュール A をモジュール実装基板 9 に実装するのに都合がよいものとなる。なお、導体膜 7 a を端子 9 4 にハンダを用いて接合する際には、そのハンダを端子部 7 1 に対しても接触させることができる。したがって、この場合においても赤外線データ通信モジュール A の実装強度を十分に高めることができる。

次に、図 1 8 及び図 1 9 を参照して説明する。これらの図は、本発明の第 2 実施例に基づく赤外線データ通信モジュールを示す図である。この赤外線データ通信モジュール A では、図 1 8 に示すように、基板 1 a の裏面 1 0 b に設けられる端子部 7 1 が略矩形状に延びて形成されている。すなわち、第 1 実施例で示した基板 1 の裏面 1 0 b のダミーエリア 2 1 において、上記したダミーパターン 2 2 が形成されることに代わり、この端子部 7 1 が形成されている。

通常、赤外線データ通信モジュール A の製造方法では、基板 1 の裏面 1 0 b において、たとえばフォトリソグラフィ法によって、端子部 7 1 を露出させるようにして絶縁層を形成する場合、たとえば、端子部 7 1 に対応した窓孔をもつマスクを用いて露光を行う。そして、現像することによって不要部分を除去する。

この第 2 実施例では、端子部 7 1 が略矩形状に延びて形成されているので、露光用のマスクが多少ずれて装着された場合でも、端子部 7 1 の長手方向に対し

てはこのずれ分を吸収することができる。そのため、端子部 7 1 の露出領域を有効に確保することができる。また、モジュール実装基板 9 との接合において支障のない大きさの端子部 7 1 を露出させて形成することができる。

すなわち、図 1 9 に示すように、赤外線データ通信モジュール A をモジュール実装基板 9 にハンダ付けにより実装する場合、上記基板 1 は、その裏面 1 0 a がモジュール実装基板 9 の表面に対して直交するように実装される。この場合、基板 1 の端子部 7 1 とモジュール実装基板 9 の配線パターン P との間にハンダフィレット F が形成される。このとき、端子部 7 1 が略矩形状に延びて形成されているので、ハンダフィレット F を適量な範囲内で多量に形成させることができる。そのため、ハンダフィレット F を十分に付着した状態に形成でき、端子部 7 1 と配線パターン P とを堅固に接合させることができる。したがって、赤外線データ通信モジュール A のモジュール実装基板 9 に対する実装強度を向上させることができる。

より具体的には、端子部 7 1 は、モジュール実装基板 9 の表面に対して凸となる方向に延びて形成されている。すなわち、モジュール実装基板 9 の配線パターン P の幅は限られているため、基板 1 a の裏面 1 0 b において、その長手方向に対して端子部 7 1 の幅を広げることには限界がある。しかしながら、端子部 7 1 は、モジュール実装基板 9 の表面に対して凸となる方向に延びて形成されているので、基板 1 a の短手方向において、端子部 7 1 を可能な限り延ばすことができる。そのため、その方向における端子部 7 1 においてハンダフィレット F を十分に形成することができる。したがって、端子部 7 1 と配線パターン P とをより堅固に接合させることができる。

請求の範囲

1. 基板の表裏面に所定の配線パターンを形成するパターン形成工程と、
上記基板の片面上に複数組の発光素子と受光素子とを含む一群の部品を搭

5 載する搭載工程と、

上記基板上に搭載された上記一群の部品を樹脂封止する封止工程と、

上記樹脂封止がなされた一群の部品を、上記発光素子と上記受光素子とが
1組ずつの組み合わせとされた複数の赤外線データ通信モジュールとして分割す
る分割工程と、を有している、赤外線データ通信モジュールの製造方法であって、

10 上記封止工程においては、上記一群の部品を封止する樹脂を、互いに分離
した複数の樹脂パッケージとして形成し、かつこれら複数の樹脂パッケージのそ
れぞれにより、上記発光素子と上記受光素子とを2組以上一括して封止すること
を特徴とする、赤外線データ通信モジュールの製造方法。

15 2. 上記搭載工程においては、複数組の発光素子と受光素子とを、上記基板の
片面上において縦横のそれぞれの方向に複数列ずつ配列し、

上記封止工程においては、上記縦横のいずれの方向においても上記樹脂
パッケージを複数ずつ並ぶように形成する、請求項1に記載の赤外線データ通信
モジュールの製造方法。

20 3. 上記基板は、一定方向に延びる帯状または長矩形状であるとともに、上記
基板には、その短手方向に延びる複数のスリットが上記基板の長手方向に間隔を
隔てて設けられており、かつ上記基板の片面のうち、上記複数のスリットの各間
の領域に、上記一群の部品が搭載されている、請求項1に記載の赤外線データ通
25 信モジュールの製造方法。

4. 上記パターン形成工程においては、上記基板の裏面に、上記基板の厚み方
向に貫通するスルーホールに接続される端子部を形成するとともに、上記端子部
と同等の厚みを有するダミーパターンを形成する、請求項1に記載の赤外線デー

タ通信モジュールの製造方法。

5. 上記パターン形成工程においては、上記基板の裏面に、上記基板の厚み方向に貫通するスルーホールに接続するとともに、外部の実装基板に接合し、かつ略矩形状に延びるように端子部を形成する、請求項1に記載の赤外線データ通信モジュールの製造方法。

6. 基板の表裏面に所定の配線パターンを形成し、上記基板の片面上に搭載された複数組の発光素子と受光素子とを含む一群の部品を樹脂封止し、上記樹脂封止がなされた一群の部品を、上記発光素子と上記受光素子とが1組ずつの組み合わせとされた複数の赤外線データ通信モジュールとして分割することにより製造される、赤外線データ通信モジュールであって、

上記一群の部品を封止する樹脂を、互いに分離した複数の樹脂パッケージとして形成し、かつこれら複数の樹脂パッケージのそれぞれにより、上記発光素子と上記受光素子とを2組以上一括して封止することにより製造されたことを特徴とする、赤外線データ通信モジュール。

7. 上記基板には、その厚み方向に貫通するスルーホールが形成され、

上記基板の裏面には、上記スルーホールと接続された端子部が形成されるとともに、上記端子部の厚みと同等の厚みを有するダミーパターンが形成された、請求項6に記載の赤外線データ通信モジュール。

8. 上記基板の表面には、発光素子及び受光素子の組を各組ごとに区画化して搭載するための個別エリアが形成され、

上記個別エリア内には、配線パターンが形成され、

上記ダミーパターンは、上記配線パターンに対極し、かつ上記配線パターンの全体的形状に対応して形成された、請求項7に記載の赤外線データ通信モジュール。

9. 上記基板には、その厚み方向に貫通するスルーホールが形成され、
上記基板の裏面には、上記スルーホールに接続され、かつ外部の実装基板
に接合するための端子部が設けられ、
上記端子部は、略矩形状に延びて形成された、請求項6に記載の赤外線デー
5 タ通信モジュール。
10. 上記基板は、その裏面が上記実装基板の表面に対して直交するように実装
される場合、上記端子部は、上記実装基板の表面に対して凸となる方向に延びて
形成される、請求項9に記載の赤外線データ通信モジュール。

要約書

- 赤外線データ通信モジュールの製造方法は、基板（１）の表裏面（１０ a, １０ b）に所定の配線パターンを形成するパターン形成工程と、基板（１）の片
- 5 面上に複数組の発光素子（２）と受光素子（３）とを含む一群の部品を搭載する搭載工程と、基板（１）上に搭載された一群の部品を樹脂封止する封止工程と、樹脂封止がなされた一群の部品を、発光素子（２）と受光素子（３）とが１組ずつの組み合わせとされた複数の赤外線データ通信モジュール（４）として分割する分割工程とを有している。封止工程においては、一群の部品を封止する樹脂を、
- 10 互いに分離した複数の樹脂パッケージ（４）として形成し、かつこれら複数の樹脂パッケージ（４）のそれぞれにより、発光素子（２）と受光素子（３）とを２組以上一括して封止する。